

股票简称：安集科技

股票代码：688019

安集微电子科技（上海）股份有限公司

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd.

上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层



以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）



新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

二〇二三年二月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会实施；本次发行具体方案及其他发行相关事宜已经2022年12月1日、2023年1月12日、2023年2月22日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

二、本次发行面向特定对象发行，本次发行的发行对象为平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

三、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币207,136,218.90元（已扣除财务性投资影响），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

公司将审议本次证券发行方案的董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额从本次募集资金总额中予以扣除，本次募集资金扣

减财务性投资后的具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	扣减财务性投资后拟使用募集资金投入金额
1	宁波安集化学机械抛光液建设项目	11,950.00	11,950.00	11,950.00
2	安集科技上海金桥生产线自动化项目	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3	安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00
4	补充流动资金	6,050.00	6,050.00	2,763.62
合计		24,000.00	24,000.00	20,713.62

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

四、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年1月4日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若本次发行的定价基准日至发行日期间，公司发生派发现金股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书规定的程序和规则，确定本次发行的发行价格为162.77元/股。

五、根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为1,272,570股，不超过

200.00万股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的30%。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

六、本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

七、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《安集微电子科技（上海）股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》。

八、本次发行完成后，本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

九、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。

十、本次向特定对象发行股票完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金投资项目的使用及实施需要一定时间，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施。详见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“六、发行人董事会声明”。

特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。

十一、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）产品开发风险

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于产品技术创新要求较高。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键半导体材料的要求也在不断提高，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在产品开发方向上的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

（二）客户集中度较高风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.74%、84.99%、84.45% 和 82.19%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

（三）原材料供应及价格上涨风险

硅溶胶和气相二氧化硅等研磨颗粒为公司生产化学机械抛光液所需的重要原材料，主要直接或间接从日本等国家进口。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比分别为 50.71%、53.21%、51.27% 和 54.10%，采购相对集中。如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应中断等，或者进出口政策出现重大变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国采取出口管制，或者公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司主要从上游基础化工或精细化工行业采购原材料，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

（四）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险

当前全球经济处于周期性波动当中，叠加新冠疫情、全球政治环境不稳定等因素的影响，尚未出现经济全面复苏的趋势，面临下滑的可能。随着全球主要经济体经济增速放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下游市场及公司经营业绩造成影响。

（五）汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，受人民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益的金额分别为-141.60 万元、732.97 万元、580.71 万元和-3,997.34 万元。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

（六）交易性金融资产公允价值变动风险

青岛聚源系公司于 2020 年以自有资金认缴出资 1 亿元与其他投资方共同设立，作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票，公司将持有青岛聚源的合伙份额在报告期末按公允价值计入交易性金融资产，具体金额受中芯国际股价波动影响。2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，青岛聚源合伙份额相关交易性金融资产产生的公允价值变动损益金额分别为 8,724.30 万元、69.28 万元和-3,276.45 万元。如果未来公司对外投资的交易性金融资产的公允价值产生波动，将会对公司的经营业绩产生影响。

（七）控股股东控制及无实际控制人的风险

本次发行前，公司控股股东 Anji Cayman 直接持有公司 37.68% 的股份。本次发行后，Anji Cayman 仍处于控股地位。如果 Anji Cayman 利用其控股地位，对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，可能会损害公司及其他股东的利益，使公司面临大股东控制的风险。

由于公司无实际控制人，存在决策效率较低的风险。此外，由于公司无实际

控制人，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司或公司控股股东被收购会导致公司控制权发生变化，可能会对公司业务发展方向和经营管理产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

（八）募投项目实施风险

公司本次发行募集资金拟用于宁波安集化学机械抛光液建设项目、安集科技上海金桥生产线自动化项目、安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目和补充流动资金。

公司募投项目的实施对公司人力资源管理、资源配置、市场拓展和法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。虽然公司已在半导体材料领域积累了丰富的经验，且对本次募集资金投资项目进行了审慎的可行性研究论证，但公司所处行业市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、公司项目管理及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响，公司存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司利润水平下降的风险。

（九）发行风险

本次发行方案为向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、二级市场公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内外部因素的影响。

此外，不排除因市场环境变化、根据相关规定或监管要求而修改方案等因素的影响，导致原股份认购合同无法顺利履行的可能，本次发行方案可能因此变更或终止。因此，本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
目 录.....	8
释 义.....	10
一、一般释义.....	10
二、专业释义.....	11
第一节 发行人基本情况	14
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	14
二、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况.....	16
三、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	27
四、现有业务发展安排及未来发展战略.....	30
五、截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	33
六、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.....	33
第二节 本次证券发行概要	39
一、本次发行的背景和目的.....	39
二、发行对象及与发行人的关系.....	41
三、发行方案概要.....	43
四、本次发行是否构成关联交易.....	46
五、本次发行不会导致公司控制权发生变化.....	46
六、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件.....	47
七、本次发行符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件.....	47
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	49
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	51
一、本次募集资金使用计划.....	51
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.....	51
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....	64
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明.....	64

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	66
一、本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划.....	66
二、本次发行完成后，公司控制权结构的变化.....	66
三、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	67
四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	67
五、本次发行完成后，公司科研创新能力的变化.....	67
第五节 历次募集资金运用	68
一、最近五年内募集资金运用的基本情况.....	68
二、前次募集资金投资项目情况说明.....	69
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....	76
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论.....	76
第六节 与本次发行相关的风险因素	77
一、技术风险.....	77
二、经营风险.....	77
三、财务风险.....	79
四、控股股东控制及无实际控制人的风险.....	81
五、募集资金投资项目相关风险.....	81
六、本次发行相关风险.....	82
第七节 与本次发行相关的声明	84
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....	84
二、发行人控股股东声明.....	94
三、保荐机构（主承销商）声明.....	95
四、律师事务所声明.....	97
五、会计师事务所声明.....	98
六、发行人董事会声明.....	100

释 义

除另有说明，以下简称在本募集说明书中含义如下：

一、一般释义

安集科技、公司、本公司、发行人	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司
本次发行	指	公司以简易程序向特定对象发行股票的行为
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》
Anji Cayman	指	Anji Microelectronics Co., Ltd., 公司控股股东
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
安续投资	指	宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙）
上海安集	指	安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司
宁波安集	指	宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
台湾安集	指	台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
宁波安集投资	指	宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司
北京安集	指	北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司
安集电子材料	指	上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司
新加坡安集	指	ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD., 公司全资子公司
青岛聚源	指	青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）
安特纳米	指	山东安特纳米材料有限公司
股东大会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会
董事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
监事会	指	安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《审核规则》	指	《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、保荐人、主承销商、申万宏源承销	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

保荐		
会计师事务所、毕马威	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
报告期、最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

化学机械抛光（CMP）	指	Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中实现晶圆全局均匀平坦化的关键工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 技术由化学作用和机械作用两方面协同完成。
化学机械抛光液、抛光液、研磨液	指	由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过程中使用的主要化学材料。
研磨颗粒、纳米磨料	指	为生产化学机械抛光液所需的关键原材料，主要包括硅溶胶、气相二氧化硅和二氧化铈等品类。
湿电子化学品、工艺化学品	指	是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。
光刻	指	半导体器件制造工艺中的一个重要步骤，该步骤利用曝光和显影在光刻胶层上刻画几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩模上的图形转移到所在衬底上。
光刻胶	指	光刻中采用的感光物质，其利用光照反应后溶解度不同将掩模版图形转移至衬底上。
光刻胶去除	指	刻蚀过程中光刻胶定义的图像被转移到晶圆表面并且刻蚀到定义的深度，刻蚀之后作为刻蚀保护层或者阻挡层的剩余光刻胶需要从晶圆表面去除。
光刻胶去除剂、光阻去除剂	指	又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工艺中使用的化学材料，主要由极性有机溶剂、强碱和/或水等组成，通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶片，去除半导体晶片上的光刻胶。
刻蚀	指	去除特定区域材料的工艺过程。往往通过湿法或干法的化学反应，或者物理方法，如溅射刻蚀实现。
芯片、集成电路（IC）	指	Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
制程、节点、特征线宽	指	晶体管栅极宽度的尺寸，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。尺寸越小，表明工艺水平越高，如 130nm、90nm、28nm、14nm、7nm 等等。
逻辑芯片	指	一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来确定。
存储芯片	指	又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体

		介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，广泛应用于内存、U 盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。
模拟芯片	指	主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的芯片类型。
DRAM	指	动态随机存取存储器，属于易失性存储器。
NAND	指	闪存，属于非易失性存储器。
2D NAND	指	存储单元为平面结构的一种 NAND 存储器。
3D NAND	指	一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在一起来解决 2D 或者平面 NAND 闪存带来的限制。
晶圆（wafer）	指	集成电路制作所用到的基材片，由于其形状为圆形，故称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品。
传统封装	指	先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列直插封装（SIP）、双列直插封装（DIP）、小外形封装（SOP）、小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形式。
先进封装	指	处于前沿的封装形式和技术。目前，带有倒装芯片（FC）结构的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）、2.5D 封装、3D 封装等均被认为属于先进封装范畴。
晶圆级封装（WLP）	指	Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切割成单个芯片再进行封装。这种方案可实现更大的带宽、更高的速度与可靠性以及更低的功耗，并为用于移动消费电子产品、高端超级计算、游戏、人工智能和物联网设备的多晶片封装提供了更广泛的形状系数。
三维集成	指	将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连实现多层之间的电信号连接的技术，TSV 是三维集成技术的实现方法之一。
硅通孔（TSV）技术	指	Through Silicon Via，通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间制作垂直导通，实现芯片之间互连的新的技术解决方案。
铜阻挡层	指	集成电路后道铜导线和绝缘介质中间的一种阻挡层材料，目的是防止铜和绝缘介质发生反应或者防止铜扩散到介电层。
鳍式场效应晶体管（FinFET）	指	Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管，FinFET 命名是根据晶体管的形状与鱼鳍非常相似。这种设计可以大幅改善电路控制并减少漏电流，也可以大幅缩短晶体管的闸长。
摩尔定律	指	当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
超越摩尔	指	当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不能沿用原来的方法单纯缩小元器件尺寸来提高元器件密度。只能通过引入更加创新的三维集成来提升芯片性能，包括革命性的新材料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互连。
后道工艺	指	半导体芯片制造工艺流程中比较靠后的对晶体管进行导线连接的工艺步骤，如铜互连、金属退火等。
前道工艺	指	半导体芯片制造工艺流程中比较靠前的对晶体管性能进行控制的工艺步骤，如栅极光刻技术、离子注入技术等。

平坦化	指	在制造工艺中，通过热流程、有机层或化学机械抛光技术对晶圆表面的平整化。
铝制程、铝互连	指	用铝做连接芯片表面上半导体器件的导线。
铜制程、铜互连	指	用铜做连接芯片表面上半导体器件的导线。铜导线电阻比铝导线低 40%，采用铜导线的器件速度快 15%。
导体	指	具有低电阻和高电导率的材料。
介电材料	指	属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击穿等现象的材料。在化学机械抛光领域，介电材料通常指二氧化硅、氮化硅等绝缘材料。
浅槽隔离（STI）	指	即 Shallow-Trench Isolation。通常用于 0.25 μm 以下工艺，通过利用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中填充淀积氧化物，用于与硅隔离。
宽禁带半导体、第三代半导体	指	使用禁带宽度在 2.3eV 及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓等）的半导体器件。
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会。
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会。

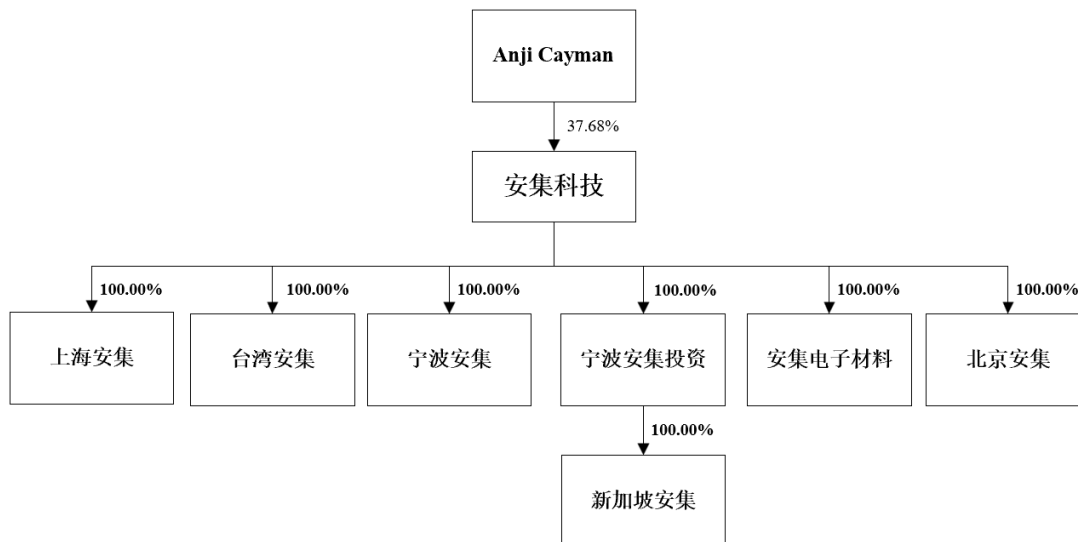
注：本募集说明书中若各分项数值直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 发行人基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股权结构

截至 2022 年 12 月 31 日，公司股权结构如下图：



（二）发行人的前十大股东情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	持有有限售 条件股份数 量 (股)	股东性 质
1	Anji Microelectronics Co., Ltd.	28,144,459	37.68	0	其他
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5,438,545	7.28	0	国有法人
3	全国社保基金四零六组合	1,817,304	2.43	0	其他
4	上海大辰科技投资有限公司	1,700,039	2.28	0	境内非 国有法人
5	香港中央结算有限公司	1,435,394	1.92	0	其他
6	中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	800,000	1.07	0	其他
7	上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	709,871	0.95	0	其他
8	中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	700,000	0.94	0	其他

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比 例 (%)	持有有限售 条件股份数 量 (股)	股东性 质
9	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞6号瑞行基金	675,272	0.90	0	其他
10	宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	598,565	0.80	0	其他
合计		42,019,449	56.25	0	-

（三）发行人控股股东、实际控制人情况

截至 2022 年 12 月 31 日，Anji Cayman 持有公司 28,144,459 股股份，占公司股份总数的 37.68%，为公司控股股东，公司无实际控制人。自上市以来，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。

截至 2022 年 12 月 31 日，Anji Cayman 所持公司股份不存在质押、冻结情况，除直接控制公司并间接控制公司全资子公司外，Anji Cayman 不存在直接或间接控制其他公司或企业的情形。Anji Cayman 的基本情况如下：

企业名称	Anji Microelectronics Co., Ltd.		
登记证书编号	CR-137213		
成立日期	2004 年 6 月 23 日		
已授权股数	150,000,000 股		
发行股数	103,064,606 股		
住所	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands		
主要业务、主要资产的规模及分布	Anji Cayman 为一家投资控股型公司，不实际从事生产经营业务，其主要资产为持有发行人股份。		
2021 年度财务数据 (万美元)	总资产	净资产	净利润
	1,424.86	1,424.86	1.21

注：以上财务数据未经审计。

截至 2022 年 12 月 31 日，Anji Cayman 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数额 (股)	持股比例 (%)
1	RUYI Holdings Inc.	24,752,880	24.02
2	Northern Light Venture Fund II,L.P.	19,892,759	19.30
3	Northern Light Strategic Fund II,L.P.	2,598,860	2.52
4	Northern Light Partners Fund II,L.P.	245,561	0.24
5	Yuding Limited	17,990,736	17.46

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
6	Oriental Wall Limited	17,184,676	16.67
7	CRS Holdings Inc.	6,761,900	6.56
8	SMS Global Holdings Inc.	5,443,346	5.28
9	SGB Holdings Inc.	5,383,598	5.22
10	Anjoin Company Limited	2,810,290	2.73
合计		103,064,606	100.00

二、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）发行人所处行业

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业——C3985 电子专用材料制造”。按照行业界的一般分类标准，公司所处行业为半导体材料行业。

公司产品作为新一代信息技术产业用材料，属于战略性新兴产业中新一代信息技术产业和新材料产业的交叉领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“1 新一代信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.3 高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造（C3985 电子专用材料制造）”。

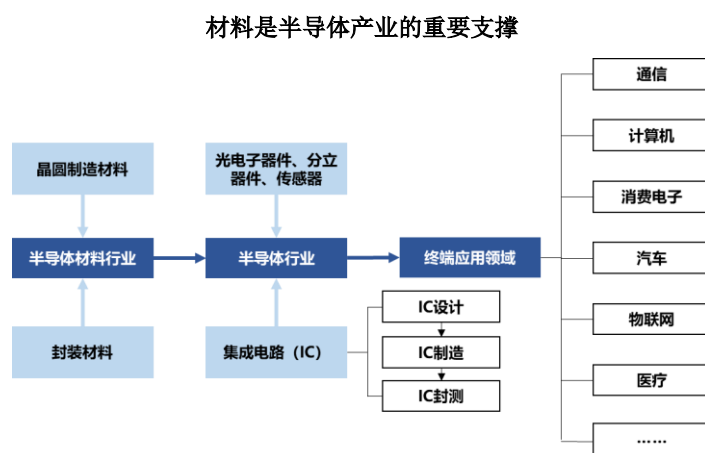
（二）所属行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

1、半导体材料行业概况

材料和设备是半导体产业的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。一代技术依赖于代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期

长等特点。



第一，产业规模大。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料。根据 SEMI，2021 年全球半导体材料销售额为 643 亿美元，相较于 2020 年的 555 亿美元同比增长 15.9%，其中晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为 404 亿美元和 239 亿美元，同比增长率分别为 15.5% 和 16.5%。从地区来看，2021 年中国台湾凭借其强大的晶圆代工和先进封装基础，以 147 亿美元连续第十二年成为半导体材料的最大消费地区，增长率 15.7%；中国大陆由于积极建厂，半导体材料市场销售额 119 亿美元，增长率 21.9%，继续超越韩国位列第二。

第二，细分行业多。半导体材料行业是半导体产业链中细分领域最多的产业链环节，其中晶圆制造材料包括硅片、光掩模、光刻胶、光刻胶辅助材料、工艺化学品、电子特气、抛光液和抛光垫、靶材及其他材料，封装材料包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包封材料、芯片粘结材料及其他封装材料，每一种大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品，细分子行业多达上百个。

2019 年全球晶圆制造材料和封装材料市场结构



资料来源：SEMI

第三，技术门槛高、研发投入大、研发周期长。由于半导体材料尤其是晶圆制造材料在集成电路芯片制造中扮演着重要的角色，甚至部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，因此下游客户对于产品的要求极为苛刻，在上线使用前需要长周期的测试论证工作，并且上线使用后也会通过较长周期逐步上量。加之产品在能够进入测试论证阶段之前需要经历长时间、高难度的研发阶段，研发过程中需要大量的研发投入。

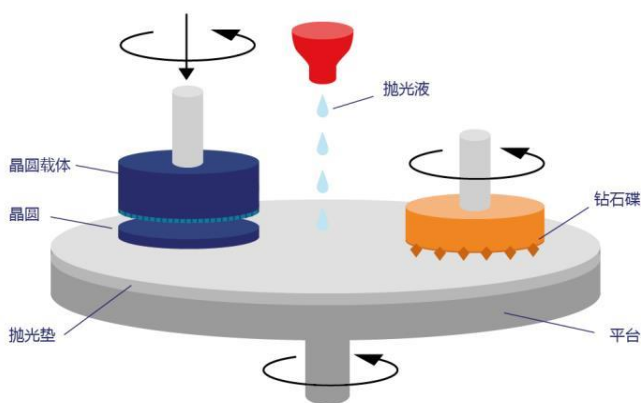
2、化学机械抛光液和湿电子化学品细分领域市场情况

制造更先进技术节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成技术需要更多的工艺步骤，带来更高的晶圆制造材料和封装材料消耗需求。根据 SEMI，2020 年全球主要晶圆制造材料中，光刻胶及光刻胶辅助材料、湿电子化学品和 CMP 抛光材料增长最为强劲，其中 CMP 抛光材料和湿电子化学品市场规模分别增长 15% 和 17%，主要受益于工艺步骤增加使得 CMP 抛光材料和湿电子化学品需求量增加。

（1）化学机械抛光液市场情况

化学机械抛光（CMP）是半导体先进制程中的关键技术，其主要工作原理是在一定压力下及抛光液的存在下，被抛光的晶圆对抛光垫做相对运动，借助纳米磨料的机械研磨作用与各类化学试剂的化学作用之间的高度有机结合，使被抛光的晶圆表面达到高度平坦化、低表面粗糙度和低缺陷的要求。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片晶圆在生产过程中都会经历几道甚至几十道的 CMP 抛光工艺步骤。与传统的纯机械或纯化学的抛光方法不同，CMP 工艺是通过表面化学作用和机械研磨的技术结合来实现晶圆表面微米/纳米级不同材料的去除，从而达到晶圆表面的高度（纳米级）平坦化效应，使下一步的光刻工艺得以进行。

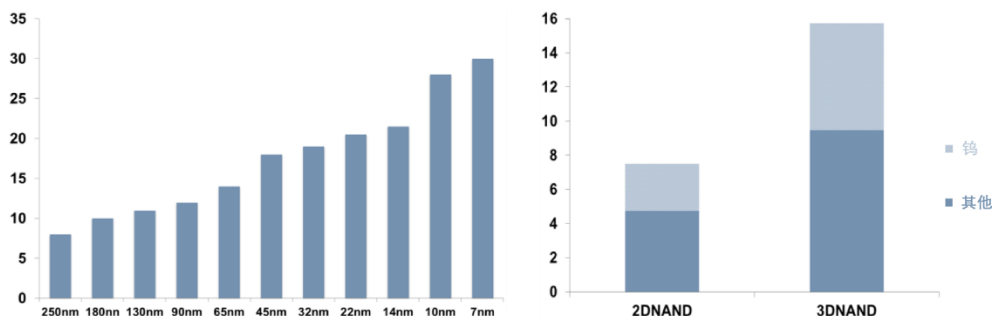
CMP 工艺原理图



随着制程节点的进步，CMP 技术越来越重要，已成为 $0.35\ \mu\text{m}$ 以下制程不可或缺的平坦化工艺，且随着多层布线的数量及密度增加，其对后续工艺良率的影响越来越大。此外，先进封装技术的应用使 CMP 从集成电路前道制造环节走向后道封装环节，如硅通孔（TSV）等先进封装技术对引线尺寸要求更小更细，因此会引入刻蚀、光刻等工艺，而 CMP 作为每道工艺间的抛光工序，得以广泛应用。

对于逻辑芯片，制程的缩小意味着光刻次数、刻蚀次数增加，也带动 CMP 工艺步骤数增加。例如 14 纳米技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺步骤数将由 180 纳米技术节点的 10 次增加到 20 次以上，而 7 纳米及以下技术节点的逻辑芯片制造工艺所要求的 CMP 工艺步骤数甚至超过 30 次。此外，更先进的逻辑芯片工艺可能会要求抛光新的材料，为抛光液带来了更多的增长机会。同样地，对于存储芯片，随着由 2D NAND 向 3D NAND 演进的技术变革，也会使 CMP 工艺步骤数近乎翻倍，带动了钨抛光液及其他抛光液需求的持续快速增长。

CMP 工艺步骤数随逻辑芯片和存储芯片技术进步而增加



数据来源：Cabot Microelectronics 官网公开披露的资料

化学机械抛光液在 CMP 技术中至关重要，在抛光材料中价值占比约 50%，

其耗用量随着晶圆产量和 CMP 平坦化工艺步骤数增加而增加。根据应用的不同工艺环节，可以将抛光液分为硅抛光液、铜及铜阻挡层抛光液、钨抛光液、介质层抛光液、浅槽隔离（STI）抛光液以及用于先进封装的硅通孔（TSV）抛光液等。抛光液特点为种类繁多，即使是同一技术节点根据不同客户的工艺技术要求也有不同配方，其主要原料包括纳米磨料、各种添加剂和超纯水。其中，纳米磨料是决定抛光液性能的关键原料，主要包括硅溶胶、气相二氧化硅和二氧化铈等品类，约占抛光液价值的三分之一。

根据 TECHCET，2021 年全球晶圆制造用抛光液市场规模为 18.9 亿美元，较 2020 年增长 13%；预计 2022 年将增长 9% 超过 20 亿美元，2026 年将达到 26 亿美元。根据中金公司证券研究报告，国内抛光液市场增速有望显著高于全球市场，2025 年国内抛光液市场有望占全球市场的 25%，达 40 亿元，2021-2025 年复合增长率达 15%。

（2）湿电子化学品市场情况

湿电子化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组成成分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品和功能性湿化学品两大类。通用湿化学品以高纯溶剂为主，例如过氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等。功能湿化学品是指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括光刻胶剥离液、清洗液、刻蚀液、电镀液及其添加剂等。

具体而言，功能性湿电子化学品在半导体制造领域的应用主要涉及光刻、刻蚀、离子注入、CMP、金属化、电镀等工艺。光刻工艺结束后，下一步工艺为刻蚀工艺，首先用到的湿化学品为刻蚀液，通过特定的溶液与需要刻蚀的薄膜材料发生化学反应，除去光刻胶未覆盖区域的薄膜，被称为湿法刻蚀。刻蚀后，需要对未曝光部分的光刻胶进行去除，此时用到的湿化学品为光刻胶剥离液，剥离液要求对光刻胶有较强的溶解性能。在金属化工艺中，应用的主要湿化学品为铜电镀液，起到芯片铜互连的作用，铜互连工艺具有更低的电阻率、抗电迁移性，能够满足芯片尺寸越小、功能越强大、能耗更低的技术性能要求。清洗液用于半导体制造的清洗工艺，去除灰尘、微粒、金属或离子型导电污染物及有腐蚀作用的

无机、有机污染物等。根据其应用工艺不同，清洗液可分为化学机械抛光（CMP）后清洗液、铝工艺刻蚀后清洗液、铜工艺刻蚀后清洗液等。

湿电子化学品的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。随着集成电路技术的不断发展，湿电子化学品必须与之同步发展。以逻辑芯片制造工艺为例，根据 CMC Materials 官网公开披露的资料，5 纳米技术节点所要求的总工艺步骤数将由 28 纳米技术节点的 400 次左右增加到 1,200 次以上，其中清洗工艺步骤数占总工艺步骤数的 25~30%，进一步带动了高端湿电子化学品的需求。此外，随着技术节点的进步，下游客户对纯度及污染物控制的要求也会提高，以避免可能引致的产品缺陷。

根据中国电子材料行业协会统计，2020 年全球集成电路用湿化学品市场规模 52.31 亿美元，同比增长 6.13%，预计 2022 年将增长到 56.90 亿美元，2025 年将进一步增加到 63.81 亿美元；2020 年中国集成电路用湿化学品总体市场规模达到 6.68 亿美元，预计 2025 年将增长至 10.27 亿美元。

3、公司取得的科技成果与产业深度融合情况

随着摩尔定律的发展，集成电路制程节点从 1971 年 10 微米一直发展到现在的 10 纳米、7 纳米、5 纳米。公司与行业领先客户建立了长期合作关系，有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

逻辑芯片方面，各晶圆制造厂商的市场地位基本由其最先进制程节点所决定。从逻辑芯片制造最先进技术节点来看，目前台积电处于绝对领先地位。中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 0.35 微米到 FinFET 不同技术节点的晶圆代工与技术服务。

存储芯片方面，从细分产品来看，目前 DRAM 和 NAND Flash 占据了 95% 以上的市场份额。其中，DRAM 芯片由三星、SK 海力士和美光合计占据了超过 95% 市场份额，NAND Flash 形成了由三星、铠侠、西部数据、美光、SK 海力士、英特尔六大原厂组成的稳定市场格局。近年来，我国在存储芯片领域实现了 DDR3/4 DRAM 及 64/128 层 3D NAND 闪存颗粒技术突破，并初步实现规模量产和产能释放。

公司的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入半导体行业领先客户的主流供应商行列。

（三）行业整体竞争格局及市场集中情况

1、行业竞争格局及公司市场地位

（1）行业竞争格局

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，报告期内收入均来自于半导体行业，其中化学机械抛光液收入占比均超过 80%。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。从行业竞争格局看，全球集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品行业依然由美国、日本等厂商占据绝对主导。

全球化学机械抛光液市场长期以来被美国和日本企业所垄断，其中 CMC Materials（已于 2022 年 7 月被 Entegris 收购）全球抛光液市场占有率最高，但是已经从 2000 年约 80% 下降至 2020 年约 30%。随着制程的演进，抛光液的种类不断丰富，技术难度不断增加，下游客户的需求也逐渐多样化，龙头企业难以在所有细分领域形成垄断。公司成功打破了国外厂商的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。最近三年，公司化学机械抛光液全球市场占有率稳步提升。

湿电子化学品领域，欧美企业和日本企业分别占据了全球 32% 和 30% 的市场份额，其中集成电路领域湿电子化学品 95% 以上市场份额被国外企业占据，国内企业全球市占率不足 5%。功能性湿电子化学品技术门槛高，美资企业在全世界拥有的优势明显，目前国内量产集成电路领域功能性湿电子化学品部分品类并形成供应的主要企业还包括上海新阳。

公司简称	安集科技	CMC Materials	Entegris	上海新阳
化学机械抛光液	●	●		
功能性湿电子化学品	●	●	●	●
总部	中国	美国	美国	中国

注：“●”表示主要产品涉足领域。

（2）公司市场地位

公司自成立之初就将自己定位为高端半导体材料领域的一站式合作伙伴，率先选择技术难度高、研发难度大的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，并持续专注投入，已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。报告期内，公司主要客户均为领先的集成电路制造厂商。目前公司的竞争对手仍主要为美国和日本综合性的材料公司。

2、行业内主要企业情况

（1）CMC Materials

CMC Materials, Inc.是全球第一大化学机械抛光液供应商和第二大化学机械抛光垫供应商。2022年7月，Entegris完成对CMC Materials的收购。

2021年，CMC Materials总收入12.00亿美元，其中电子材料（包括CMP抛光液、CMP抛光垫、电子化学品等）收入9.85亿美元，占比82%，抛光液和抛光垫收入分别为5.47亿美元和0.95亿美元；功能性材料收入2.15亿美元，占比18%。2021年，CMC Materials来自中国大陆的收入为1.58亿美元，占比13%。

（2）Entegris

Entegris, Inc.是全球领先的半导体及其他高科技行业先进材料和工艺解决方案供应商，拥有特殊化学品和工程材料、微污染控制、先进材料处理三大业务分部。其中，特殊化学品和工程材料分部提供高性能和高纯度的工艺化学品、气体和材料。截至2021年末，Entegris提供了超过20,000种标准化和定制化产品，2021年度没有单一产品平台净销售额占比超过4%。

2021年度，Entegris净销售额22.99亿美元，其中特殊化学品和工程材料业务分部净销售额7.11亿美元，占比31%。2021年，Entegris来自中国大陆的收入占比为16%。

（3）上海新阳

上海新阳半导体材料股份有限公司（300236）所从事的主要业务分为两类，一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、

生产及相关服务业务，并为客户提供专业的整体涂装业务解决方案。

2021年度，上海新阳营业收入10.16亿元，其中半导体行业收入5.02亿元，占比49.44%。

3、进入行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

化学机械抛光液和功能性湿电子化学品是化学、化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，产业链整体壁垒较高，属于典型的技术密集型产业，对技术、工艺、专利等要求严格。特别是集成电路领域高端产品，对产品配方及生产工艺流程控制要求更高，对技术把控需要长时间的经验性积累。

长期以来，以美国和日本为代表的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品供应商利用先发优势，掌握核心技术，并在研发和生产方面不断革新，同时实行非常严格的保密和专利保护措施，对新进入行业的企业构筑了难以突破的技术壁垒。特别是对于新产品开发而言，开发周期长、技术要求高，对企业的研发能力、技术水平和生产工艺提出了更高的要求。

（2）人才壁垒

集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品的技术含量高，研发及产业化需要大批专业背景深厚、实践经验丰富的高层次技术人才。这些人才具备复合专业知识结构，准确把握行业和技术的发展趋势，并且需要在长期实践工作中积累应用经验，以深刻理解生产工艺中的关键技术环节，开发出满足下游客户需求的产品。公司的产品在销售给客户后，需要经验丰富的工程师提供专业的技术支持服务，协助客户将产品应用到具体产线。

全球范围内，美国和日本等垄断厂商人才储备充足，而国内集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品产业起步较晚，滞后的人才培养导致国内专业人才匮乏，构成新进入企业的主要壁垒之一。

（3）客户壁垒

在逻辑芯片、存储芯片等集成电路技术不断推进过程中，与行业内领先客户联合开发成为关键半导体材料企业成功的先决条件。由于集成电路领域化学机械

抛光液和湿电子化学品技术含量高，其产品质量、性能指标直接决定了终端产品的品质和稳定性，属于下游客户的关键材料。因此，下游客户实施严格的供应商认证机制，只有通过严格的认证满足客户对质量标准和性能的要求，才能成为下游客户的合格供应商。

由于下游客户需要对供应商进行严格的供应商认证和定期考核，产品一旦通过下游客户的认证，客户更换供应商时通常需要评估成本、所需的时间和对生产的影响，更换时间长、成本高。因此供应商一旦通过下游客户的认证成为其合格供应商，就会形成相对稳定的合作关系。新进入企业只有在技术水平、供应价格、产品质量和后续服务等方面显著超过原有供应商，才有可能获得客户订单。

（4）资金壁垒

关键半导体材料的研发和产业化是一项投入大、周期长的系统性工程，产品从研究开发、性能检测到最终的产业化实现销售，需要投入大量的资金，用于建造实验室和生产车间、引进先进的研发生产设备和精密的检验测量仪器。

快速的技术升级和产品更新是半导体行业最显著的特点，也是推动行业发展的动力。随着下游应用领域发展速度不断加快，市场竞争加剧，生产技术标准越来越严格，集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品生产企业只有具备雄厚的资金实力，不断加大对产品研发和产业化的投资力度，才能匹配下游行业更新换代快的要求，从激烈的市场竞争中脱颖而出。

（四）公司所处行业与上、下游行业之间的关联性及其上下游行业发展状况

1、与上游行业之间的关联性及其上游行业发展状况

公司主要产品包括化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，生产所需的主要原材料包括酸碱和有机溶剂等化工原料、纳米磨料等，上游行业为化工行业。

我国化工产业经过多年发展，已建立了较为完善的化工工业体系，化工产品原料品种齐全，生产能力和产量较大，但总体水平与发达国家还有一定差距。我国化工产业中，以生产大宗基础化工产品为主的石油化工、煤化工等传统产业仍然占据主导地位，而精细化工产品特别是高端精细化学品产业规模小、发展水平低。全球主要高端化学品企业均为国外企业，例如德国巴斯夫公司、美国陶氏杜邦公司、日本三菱化学公司等，它们均具有从基础化学品到高端化工材料的全链

条加工及研发能力。我国在高端化工新材料产品和化工高端装备及尖端技术方面对国外依赖度较高，以生产化学机械抛光液所需的关键原材料纳米磨料为例，主要包括硅溶胶、气相二氧化硅和二氧化铈等大类，约占抛光液价值的三分之一，目前主要从日本等国家进口。

公司上游行业除受到原油、煤炭及采矿冶金等行业的影响外，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料供应的稳定性、及时性和价格也可能产生一定的波动，进而对公司所处半导体材料行业发展产生一定影响。

报告期内，就上游供应商而言，公司与主要供应商保持着长期、稳定的合作关系，根据客户需求及生产计划采购原材料，原材料供应稳定、充足。同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，公司开始建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。

2、与下游行业之间的关联性及下游行业发展状况

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，是半导体产业的基石和推动集成电路技术创新的引擎，对半导体产业发展起着重要支撑作用，与下游半导体市场的发展紧密相关。根据 WSTS 统计，全球半导体产业销售额已从 2000 年的 2,044 亿美元增长至 2021 年的 5,559 亿美元，并从中国台湾、日本、韩国向中国大陆转移。

在下游市场的驱动以及政府与资本市场的推动下，中国集成电路产业获得了强大的发展动力，保持快速增长态势。根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业首次突破万亿元，由 2012 年的 2158.5 亿元增长至 2021 年的 10,458.3 亿元，年均复合增长率近 20%。

公司主要产品化学机械抛光液和功能性湿电子化学品作为关键半导体材料，市场空间和晶圆制造产能密不可分。全球特别是中国晶圆制造产能增长，将带动公司主要产品需求增长。根据 SEMI 预计，全球半导体行业将在 2021 至 2023 年间开始建设的 84 座大规模芯片制造工厂中投资 5,000 多亿美元，其中包括汽车和高性能计算在内的细分市场将推动支出增长，增长预期包括 2022 年开始建设的 33 家新工厂和预计 2023 年将新增的 28 家工厂。其中，预计中国大陆新芯片制造工厂数量将超过所有其他地区，计划有 20 座支持成熟工艺的工厂/产线；预

计中国台湾地区将开始建设 14 个新工厂/产线。公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，根植于目前全球半导体材料的第一大市场中国台湾和第二大市场中国大陆，已进入半导体行业领先客户的主流供应商行列。

报告期内，就下游客户而言，公司与主要客户保持着长期、稳定的合作关系，且主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商，表明公司已经得到下游行业的认可，公司产品具有竞争力。

三、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司主营业务及主要产品情况

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。

在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局 and 覆盖，旨在为客户提供完整的一站式解决方案。公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液五大产品平台。同时，公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台，支持客户对于不同制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。

在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道晶圆级封装用等高端功能性湿电子化学品产品领域，致力于攻克领先技术节点难关，并基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品水平的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。目前，公司功能性湿电子化学品主要包括刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液及电镀液及其添加剂系列产品等。为进一步服务中国半导体产业国产化进程及下游客户的需求，公司结合客户需求及现有技术平台，以电化学研究为基础，研发应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其添加剂产品系列，并在报告期内取得了实质性进展：公司已初步完成电化学镀技术平台的建

立，铜电镀液添加剂在先进封装领域已进入客户验证阶段，进展顺利。电镀液及其添加剂系列产品的布局，是公司在横向拓展产品平台的重大迈步，公司在自主研发技术平台基础上，结合外部引进整合，加快电镀液及其添加剂系列产品的推出和产业化，助力国内半导体制造用关键材料自主可控供应能力的提升。

公司的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品产品已成功应用于逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、功率器件、传感器、第三代半导体及其他特色工艺芯片，并已进入半导体行业领先客户的主流供应商行列。

同时，为了提升自身产品的稳定性和竞争力，并确保战略供应，公司开始建立核心原材料自主可控供应的能力，以支持产品研发，并保障长期供应的可靠性。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司制定了《采购管理程序》和采购管理内部控制流程，并制定了《采购流程》《供应商管理流程》《供应灾难恢复程序》等标准作业程序。

（1）一般采购流程

以原、辅材料和包装材料为例，公司的一般采购主要流程如下：

1) 技术研发部提出材料开发需求，采购部负责开发供应商，并由供应商管理小组负责材料评估、供应商认证、审核、导入及批准为公司合格供应商，采购部负责建立并维护《合格供应商目录》。公司供应商管理小组由采购部、技术研发部、质量部、生产运营部等部门人员组成。

2) 需求部门提出采购申请，并按照公司审批政策得到合适的批准后提交采购部，采购部负责管理订单执行，质量部负责采购来料检验管理，仓库负责采购入库管理。

3) 采购部按照采购合同/订单，获取发票，并整理入库及验收等付款凭证提交财务部申请付款并得到审批。

4) 财务部按照采购合同/订单约定负责采购应付款管理。

（2）外协采购流程

报告期内，公司功能性湿电子化学品中的部分光刻胶剥离液存在委托外协供应商生产的情形，即公司与外协供应商签订协议，外协供应商严格按照公司提供的工艺文件、技术标准来组织生产，进行质量管理控制。公司所有的产品配方、生产工艺、任何发明、设计、技术信息、技术、专有技术或者由公司依协议授权外协供应商使用的商标、商业秘密及其他知识产权属于公司单独所有。公司的外协采购主要流程如下：

- 1) 生产运营部根据月度销售预测生成外协采购申请单；
- 2) 采购部根据外协采购申请单下订单；
- 3) 外协供应商按订单要求安排生产；
- 4) 财务部每月末进行外协采购成本核算。

2、研发模式

公司始终围绕自身的核心技术，以自主研发、自主创新为主，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制。同时，公司与高校、客户等外部单位建立了良好的合作关系，积极开展多层次、多方式的合作研发。公司的研发目标一方面系跟随行业界的技术发展路线图，研发适应产业需求的产品平台；另一方面系基于下游客户的需求，针对性研发满足客户需求的产品。由于从开始研发到实现规模化销售需要较长的时间，公司与技术领先的客户合作开发，有助于了解客户需求并为其开发创新性的解决方案。

公司制定了《研发管理制度》，并建立了研发管理内部控制流程，涵盖研发计划、研发立项、研发过程跟进和费用核算管理、专利申请和取得等环节。公司产品研发及产业化的一般路径主要包括项目论证、研发 Alpha 送样、Beta 送样试生产、商业化（规模化生产）、持续改进等五个阶段。

3、生产模式

公司在产品设计及研发前期，即投入大量资源与下游客户进行技术、品质、性能交流。当产品通过客户评价和测试后，销售部会根据客户的产品订单及对于客户使用需求的预测制定滚动出货预测，生产运营部根据年度/月度生产计划、滚动出货预测和库存情况制订具体的生产计划、安排库存。具体而言，生产运营

部每年组织各相关部门，根据排产计划编制年度生产计划及月度生产计划。生产运营部会定期进行集体评审，根据每月存货存量、滚动出货预测制定具体的生产计划，以确保生产计划满足销售合同以及生产产能的要求；生产运营部组织各相关部门、各产品线负责人召开生产调度会，对生产计划的执行情况进行评审，以确保充分沟通可能影响生产计划变更的各种因素，及时调整生产计划（如及时关闭停工订单），以确保计划调整的及时性及有效性。

公司已经掌握了化学机械抛光液和功能性湿电子化学品生产中的核心技术，通过合理调配机器设备和生产资源组织生产。

4、销售模式

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，销售主要采用直接面对终端客户的直销模式。公司在开拓新客户或在原有客户推广新产品时，首先要根据客户的需求进行认证测试，包括产品性能、可靠性、稳定性等多方面测试，认证测试周期一般较长。公司在通过下游客户认证后，客户直接向公司下达采购订单，公司按要求直接向客户发货。

四、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）现有业务发展安排

1、深耕高端半导体材料领域

公司自成立之初就将自己定位为高端半导体材料领域的一站式合作伙伴，率先选择技术难度高、研发难度大的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，并持续专注投入，已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。

公司通过多年持续投入，已拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品中。截至 2022 年 9 月 30 日，公司拥有授权专利 248 项，均为发明专利。同时，公司持续加强知识产权管理，依照国家《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）制订了完善的知识产权管理体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。公司通过完善的知识产权布局保护核心技术，持续创新并更新知识产权库，实现产品和技术的差异化，为公司开发新产品和开拓新业务创造了有利条件。

未来，公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕，依托已有的先进技术平台和人才团队为客户提供高附加值的产品和服务。

2、贴近市场和客户的服务模式

公司根植于全球半导体材料的第一大和第二大市场，更布局富有经验的应用工程师团队在当地提供 24 小时服务。根据 SEMI，2021 年中国台湾半导体材料市场规模同比增长 15.7%，达到 147.10 亿美元，继续位居全球第一；中国大陆半导体材料市场规模同比增长 21.9%，成为 2021 年增长最快的地区，达到 119.3 亿美元。贴近市场和客户的服务模式有利于公司及时响应客户需求，运输时间短，运输成本低，并且与本土客户文化融合程度高，沟通效率高，具有较强的灵活性。

3、成熟高效的全流程质量保证体系

公司秉承“客户至上、质量导向、持续创新、全面可靠”的质量方针，致力于满足并超越客户的期望。公司围绕产品导入的全流程建立了成熟有效的产品质量保证体系，在产品研发、供应商管理、进料控制、过程控制、出货控制、客户服务、产品优化和迭代等方面进行全流程质量管控并已通过 ISO9001,ISO14001,ISO45001 等管理体系的第三方认证。

（二）发行人的战略目标及未来规划

1、公司战略目标

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，自成立以来一直致力于集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品的研发，以填补国产关键半导体材料的空白。未来，公司将持续开拓创新，继续深化与中国大陆及中国台湾客户的合作，并积极开拓全球市场。同时，公司将在现有业务和技术的基础上，持续稳健地通过自建或并购延伸半导体材料产业链，目标成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴。

2、公司未来发展规划

（1）技术发展及创新计划

在抛光液领域致力于提供全面一站式解决方案，在功能性湿电子化学品领域定位技术领导者。继续加强技术创新，持续提升现有产品平台的综合能力，满足

先进制程对于产品性能的要求，根据产品路线图扩充产品品类，发掘新的增长点以全面满足客户的需求并确保经营目标的实现；提升纳米磨料等关键原材料自主可控的供应能力，加强产业链上下游合作，并且选择性建立部分关键原材料的自主制造能力；结合公司核心技术、研发平台和现有业务情况，积极论证拓展新业务的可行性，加强与外部多维度的合作。

（2）人力资源开发计划

随着新技术的不断更新迭代、公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售和运营等方面的人才储备，保障公司快速发展对人才的需求，公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售、运营等方面的专业人才以及建立联合培养基地，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

坚持“安集人，我们能”（Can-do）和“使命必达”（Must-win）的安集精神，打造学习型、合作型、充满活力、值得信赖的组织，提升组织效能。

（3）市场开拓计划

依托公司主要产品线，围绕核心客户群，坚持以客户为中心，打造技术、产品、服务为一体的客户服务团队，努力提升客户满意度，实现业务的稳步增长。针对中国市场，在化学机械抛光液和功能性湿电子化学品领域，公司除了现有产能扩产实现销售增长外，大力支持国内新建集成电路晶圆厂的技术和量产的需求，为未来业务的持续良好增长夯实基础。同时，公司积极开拓国际市场，以成为化学机械抛光液和功能性湿电子化学品的全球主流供应商。

（4）公司规范运作、运营效率及经营品质提升计划

公司将进一步完善法人治理结构，以加强内控建设为重点，完善董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会的职能作用，更好地发挥董事会在公司战略方向、重大决策等方面的作用。同时，加强关键职能部门能力建设，建立有效的评价、追踪体系，管理、优化运营成本费用，实现经营利润的稳步增长；同时兼顾长期业务发展机会，加强公司整体研发、生产、质量、原材料供应、信息化能力建设，确保公司长期发展。

通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升主要产品化学机械抛光液的生

产能力，提高公司的生产效率和工艺水平，增强公司的分析检测能力，有助于增强公司的综合竞争实力和核心技术及业务优势，进一步促进公司整体运营效率和经营品质的提升。

五、截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况

截至 2022 年 9 月末，公司可能涉及财务性投资的资产科目情况如下：

单位：万元

序号	会计科目	截至2022.9.30 账面价值	占公司2022.9.30合并报 表归属于母公司股东的 净资产的比例	是否属于财务 性投资
1	交易性金融资产	14,648.11	10.40%	否
2	其他应收款	303.03	0.22%	否
3	其他流动资产	1,254.00	0.89%	否
4	长期股权投资	4,939.04	3.51%	否
5	其他权益工具投资	891.87	0.63%	否
6	其他非流动金融资 产	8,427.08	5.98%	是
7	其他非流动资产	4,294.46	3.05%	否
合计		34,757.59	24.67%	-

截至 2022 年 9 月末，公司其他非流动金融资产系所投资嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥溯慈企业管理合伙企业（有限合伙）（专项用于认购“合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）”有限合伙人份额）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）等产业基金。考虑公司对该等产业基金不具有实际管理权或控制权等原因，基于谨慎性原则，公司将对该等产业基金的投资认定为财务性投资。截至 2022 年 9 月末，公司该等财务性投资账面价值 8,427.08 万元，占公司合并报表归属于母公司股东的净资产的比例为 5.98%，公司截至最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

六、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，核心技术权属清晰，技术水平国际先进或国内领先，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司的核心

技术涵盖了整个产品配方和工艺流程，包括金属表面氧化（催化）技术、金属表面腐蚀抑制技术、抛光速率调节技术、化学机械抛光晶圆表面形貌控制技术、光阻清洗中金属防腐蚀技术、化学机械抛光后表面清洗技术、光刻胶残留物去除技术、选择性刻蚀技术、电子级添加剂纯化技术、磨料制备技术、电镀技术等。

电镀是集成电路制造关键工艺。在集成电路制造及先进封装中，电镀广泛应用于集成电路制造大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、先进封装凸点工艺（bump）以及再分布线（RDL）工艺，实现金属互联。电镀液及其添加剂是实现电镀技术的关键材料。公司结合客户需求及现有技术平台，在电化学研究基础上，初步完成电化学镀技术平台的建立。

公司核心技术的应用主要体现在产品配方和生产工艺流程两个方面。一方面，公司基于核心技术研发产品配方并通过申请专利等方式加以保护，产品配方是核心技术的具体体现。另一方面，生产工艺流程是公司产品生产过程中的关键，也是核心技术转化为最终产品的实现手段，公司通过技术秘密等形式对生产流程予以保护。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其子公司共获得 248 项发明专利。公司主要依靠核心技术开展生产经营，核心技术产品为集成电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品。

（二）保持科技创新能力的机制和措施

1、技术研发部门设置及人员情况

公司技术研发部主要负责规划技术发展路线蓝图，新产品的的设计，开发、专利申请保护；与客户及合作伙伴共同开发新产品，确定新的技术标准；拓展产品的客户群，对现有产品持续改善；制定公司技术管理制度、质量控制，各类技术文件编制；在公司内部和外部开展技术培训及技术交流；以及收集产品在客户端的测试结果和反馈，及时解决产品出现的技术问题。此部门由化学机械抛光液、湿电子化学品研发团队和技术应用团队组成，分别针对化学机械抛光液、湿电子化学品进行研究开发和测试论证，并协同市场及新事业拓展部跟踪最新技术、市场的动向和客户技术需求，共同定义新产品的各项指标和性能，同时还协同质量部与供应链管理部门对新产品、新工艺、可靠性等方面的完善和把控。

公司作为技术密集型企业，高度重视研发团队的培养，已经建立起一支具备扎实专业功底、丰富技术经验的研发团队。截至 2022 年 9 月 30 日，公司研发人员 157 人，占公司总人数的比例为 40.78%。研发人员中，博士学历 22 人、硕士学历 32 人、本科学历 82 人，本科及以上学历占比 86.62%。公司核心技术团队在半导体材料行业积累了数十年的丰富经验和先进技术。

2、创新管理机制

（1）先进和包容的研发理念

公司核心技术人员多年在海外和国内从事集成电路领域化学机械抛光液和湿电子化学品配方研发、应用工艺开发和设备耗材研究，具有丰富的产品研发和成功商业化经验。在管理团队的带领下，公司鼓励创新、包容试错，培养了良好的研发创新文化，让研发团队深刻认识并理解创新的重要性，建立起了“求新、务实、追求卓越”的研发理念。

（2）高效的管理机制

在管理过程中，公司技术研发部注重：1）团队精神，协调工作。充分调动各部门技术专家、一线开发人员和技术应用团队等各方的积极性，形成全面启动、各司其职、协同作战、优势互补的机制，快速、高质量地完成任务。2）发挥优势，快速运作。充分发挥公司先进的技术优势，把技术开发作为一项战略任务，各部门全力以赴进行工作。3）强化评审，保证质量。严格执行研发项目评审程序和制度，保证资源的先进性、先导性、针对性、广泛性。

（3）市场导向的研发策略

公司坚信创新来自于市场实践，遵循市场导向的研发策略。近年来，公司在控制研发成本的同时，持续、及时推出了符合市场和客户需求的新产品，保持了较高的研发效率和技术产品转化率。在市场导向的研发策略下，公司根据市场和技术发展情况安排和调整自身的研发步调。除重大战略技术布局外，公司不进行无市场前景的研发投入，从而确保公司研发投入的有效利用和转化。

（4）完善的激励机制

公司的激励机制首先体现公平的原则，严格按制度执行并长期坚持；其次激

励制度和绩效考核相结合，激发员工的竞争意识，使这种外部推动力量转化成一种自我努力工作的动力，充分发挥人的潜能；最后是做到科学性，全面了解员工的需求和工作质量，不断地根据情况的改变制定出相应的政策。公司自成立即推出了专利创新奖励制度，对创新申请和授权的专利均给予经济奖励和精神奖励。

3、技术储备及技术创新

公司围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在化学机械抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式解决方案；在功能性湿电子化学品板块，公司专注于集成电路前道晶圆制造用及后道封装用等高端产品领域，致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的产品和解决方案。公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。

报告期内，公司继续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案，初步完成电化学镀技术平台，并在大硅片抛光系列产品、氮化硅抛光液、碳抛光液、碱性铜抛光后清洗液领域取得突破性进展。

公司已经形成的铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、功能性湿电子化学品和新材料新工艺七大产品平台在报告期内均取得了不同程度的进展和突破：

（1）铜和铜阻挡层抛光液持续上量

在铜及铜阻挡层抛光液方面，公司紧跟摩尔定律，紧跟芯片制造技术的发展和行业领先客户的先进制程，提前进行技术平台的布局及技术能力的积累，持续推进相关产品的研发，持续优化已量产的成熟技术节点产品的性能及稳定性，为进一步扩大销售提供技术支持；用于先进技术节点的产品持续在更多产品上验证，进一步扩大应用。报告期内，成熟产品在多家新建芯片制造厂作为首选供应商与客户一起合作准备量产，多款产品在逻辑和存储芯片领域持续上量，在先进制程上持续验证，拓宽应用领域。

（2）氮化硅抛光液打破国外垄断

在介电材料抛光液方面，公司持续开发及优化氮化硅抛光液。报告期内，氮化硅抛光液通过客户验证并实现量产销售，使国内具备氮化硅抛光液产品自主供应能力，同时也进一步提升了公司的介电材料抛光液产品平台的竞争力。

（3）钨抛光液在 28nm 逻辑芯片技术节点实现销售

公司钨抛光液在逻辑芯片和存储芯片领域的应用范围和市场份额持续上升，钨抛光液产品在 28nm 逻辑芯片技术节点通过验证并实现销售，多款产品在逻辑芯片成熟制程和先进制程进行测试验证，进展顺利。

（4）基于氧化铈磨料的抛光液国产自主供应能力持续加强

报告期内，公司基于氧化铈磨料的抛光液在国内领先的存储客户持续突破，多款新产品完成论证测试并实现量产销售，部分产品已成为主流，国产自主供应能力持续加强。

（5）衬底抛光液产品平台发展快速

在衬底抛光液方面，公司紧跟国内大硅片企业的发展和打造材料自主可控能力的趋势，充分了解客户的需求后定制化开发抛光液产品。报告期内，公司研发的硅精抛液取得突破，技术性能达到国际先进水平，产品在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产，部分产品已获得中国台湾客户的订单。第三代半导体作为下一代的衬底材料同样发展迅速，公司积极投入研发，为客户定制开发的用于第三代半导体衬底材料的抛光液，进展顺利，部分产品已获得海外客户的订单。

（6）建立电化学镀技术平台，功能性湿电子化学品平台持续突破

电镀是集成电路制造关键工艺。在集成电路制造及先进封装中，电镀广泛应用于集成电路制造大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、先进封装凸点工艺（bump）以及再分布线（RDL）工艺，实现金属互联。电镀液及其添加剂是实现电镀技术的关键材料。报告期内，公司结合客户需求及现有技术平台，在电化学研究基础上，初步完成电化学镀技术平台的建立，经过与客户的紧密合作，铜电镀液添加剂在先进封装领域进入验证阶段，进展顺利。公司在自主研发技术平台基础上，结合外部引进整合，加快电镀液及其添加剂系列产品的平台建设。除此之外，公司铝制程及铜大马士革工艺刻蚀后清洗液已量产并且持续扩大应用，广泛应用于 8 英寸、12 英寸逻辑电路、存储器件及特色工艺等晶圆制造领域；光刻胶剥离液

广泛应用于后道晶圆级封装等超越摩尔领域。报告期内，公司 28nm 技术节点后段硬掩膜大马士革工艺刻蚀后清洗液持续上量，在主流客户量产使用，并且已经进入中国台湾地区。抛光后清洗液方面，公司碱性铜抛光后清洗液方面取得突破，在客户先进技术节点验证进展顺利。

（7）新材料新工艺产品平台进展顺利

公司基于化学机械抛光液技术和产品平台，为客户定制开发满足不同制程的需求的用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。报告期内，定制开发的碳抛光液实现量产销售，三维集成用系列抛光液（TSV，混合键合等）在与多个客户进行合作开发和测试验证，进展顺利。

（8）核心原材料自主可控进展顺利

报告期内，公司核心原材料自主可控供应的能力得到明显提升，公司参股公司山东安特纳米材料有限公司开发的多款硅溶胶已在公司多款抛光液产品中通过内部测试，并在积极与客户合作进行测试验证中；同时，公司通过自研自建的方式持续加强了氧化铈颗粒的制备和抛光性能的自主可控能力，并有多种产品已使用国产研磨颗粒，已与客户端测试论证中，进展顺利。在功能性湿电子化学品板块，公司通过自建、合作等多种方式，加强产品及原料的自主可控，并已取得突破性进展，部分关键原材料成功实现量产并稳定使用。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、集成电路产业快速发展，带动半导体材料需求

当前，全球半导体产业已进入5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等创新技术驱动的新增长阶段。根据WSTS统计，全球半导体产业销售额已从2000年的2,044亿美元增长至2021年的5,559亿美元，并从中国台湾、日本、韩国向中国大陆转移。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元，由2012年的2158.5亿元增长至2021年的10,458.3亿元，年均复合增长率近20%。

受益于全球半导体产业特别是中国集成电路产业快速增长，中国大陆半导体材料市场规模增速全球领先。根据SEMI，2021年全球半导体材料销售额为643亿美元，相较于2020年的555亿美元同比增长15.9%，其中晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为404亿美元和239亿美元，同比增长率分别为15.5%和16.5%。从地区来看，2021年中国台湾凭借其强大的晶圆代工和先进封装基础，以147亿美元连续第十二年成为半导体材料的最大消费地区，增长率15.7%；中国大陆由于积极建厂，半导体材料市场销售额119亿美元，增长率21.9%，继续超越韩国位列第二。

2、国家政策大力支持集成电路材料产业的发展

公司主要产品化学机械抛光液和功能性湿电子化学品作为应用于集成电路领域的关键材料，属于国家重点鼓励、支持的战略性新兴产业。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期，为了加快推进我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、本土化供应的进程，国家及地方制定了一系列产业支持政策，对于提升中国集成电路产业链关键配套材料的本土供应能力起到了重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，聚焦新一代信息技术等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能；在事关国

家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程，瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。国家对集成电路产业发展的高度重视为我国半导体材料产业持续发展创造了良好的政策环境。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、完善公司业务布局，加强和保障公司产品供应能力

化学机械抛光液是制造集成电路的关键材料，长期以来被美国和日本企业所垄断，公司成功打破了国外厂商的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。受益于国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商技术的突破和成熟、国产化的成本优势等，未来集成电路领域化学机械抛光液存在较大的国产替代空间，有望进一步降低进口依赖。此外，由于半导体产业具有明显的技术驱动特征，下游集成电路制造和封测企业在制程技术上的突破和新材料、新工艺的引进，对化学机械抛光液等关键半导体材料提出了更高的要求，也给包括公司在内的半导体材料供应商带来了发展机遇。因此，公司亟需通过实施本次募投项目增加生产能力，及时把握集成电路产业快速发展和抛光液国产替代的良好机遇。同时，面对新冠疫情发展的不确定性、全球政治环境不稳定以及全球供应链紧张等环境因素，公司拟在宁波北仑基地新建化学机械抛光液生产线，打造公司化学机械抛光液第二生产基地，加强和保障产品供应能力，实现区域协调发展，同时满足客户关于供应商应设立多个生产基地以规避风险的要求，对于确保产业链供应链稳定具有重要意义。

本次募集资金部分投向“宁波安集化学机械抛光液建设项目”，建成后将新增1.5万吨化学机械抛光液生产能力，以更好地应对和满足下游市场需求，提升公司产品稳定性和综合竞争力，有助于支持和保障国内集成电路产业链供应链安全稳定

2、进一步提升公司生产线自动化水平，增强公司综合竞争力

随着公司生产规模的不断扩大，进一步提高生产线自动化水平变得日趋重要。MES和DCS是重要的生产控制类系统，通过在公司现有厂区搭建该类系统，增加对生产过程的管控，将实现从生产计划下达到生产调度、组织、执行、控制

直至生产出合格产品全过程的信息化管理，并实现对生产过程的自动控制和监视管理，进一步提升公司生产线自动化和智能化水平，增强公司的综合竞争力。

本次募集资金部分用于在公司上海金桥基地搭建MES（制造执行系统）、DCS（集散控制系统）等生产控制类系统，旨在提高公司生产线的自动化程度，进一步提升公司生产效率和工艺水平，增强公司规模化生产能力。

3、提升公司分析检测能力，加强公司产品质量控制

公司主要产品化学机械抛光液和功能性湿电子化学品属于配方型产品，在产品配方开发及产业化过程中，需筛选出合适的原材料进行复配，并确定合适的添加比例，涉及反复、大量的实验、测试、检验分析等流程。

本次募集资金部分用于购置各类分析检测仪器，可以有效提升公司分析检测能力，进而加强公司产品质量管控，保障公司高质量发展；同时，可以进一步完善公司分析检测平台，支撑公司生产过程中的质检和检测需求，有助于提高公司的技术水平和科技创新能力。

4、满足公司营运资金增长需求，增加公司抗风险能力

随着公司营业收入规模的增长，公司对营运资金的需求不断增加，保证营运资金充足对于抵御市场风险、提高竞争力和实现战略规划具有重要意义。

本次募集资金部分用于补充流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施，同时也能够进一步优化公司的财务结构，增强公司抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展。

二、发行对象及与发行人的关系

（一）发行对象

根据 2021 年年度股东大会的授权，发行人于 2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 12 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。公司独立董事对该等议案发表了同意的独立意见，认为公司本次发行的发行程序合法合规，竞价结果真实有效；公司及时与 13 名特定对象签署了附生效条件的股份认购合同，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。

本次发行对象均通过竞价方式确定，最终确定发行对象为平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安股票优选 1 号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家 13 号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金。

本次发行的发行对象均已承诺本次认购款项为其自有或其所管理产品的资金，资金来源合法且符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定；其与发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方之间不存在关联关系，其参与本次发行的认购资金不存在代持、结构化安排或者直接间接使用发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方资金用于本次认购的情形，发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方也未间接通过其参与本次申购；不存在发行人及其控股股东、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在发行人及其控股股东、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

（二）发行对象与发行人的关系

本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

三、发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

（三）发行对象及认购方式

本次发行对象为平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年1月4日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书规定的程序和规则，确定本次发行的发行价格为 162.77 元/股。

（五）发行数量

根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 1,272,570 股，不超过 200.00 万股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的 30%。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

本次发行具体获配情况如下：

序号	认购对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	95,442	15,535,094.34
2	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	53,023	8,630,553.71
3	平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	95,442	15,535,094.34
4	平安养老保险股份有限公司-平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	53,023	8,630,553.71
5	平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	53,023	8,630,553.71
6	平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	53,023	8,630,553.71
7	平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	53,023	8,630,553.71
8	平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	53,023	8,630,553.71
9	财通基金管理有限公司	249,216	40,564,888.32
10	诺德基金管理有限公司	196,187	31,933,357.99
11	上海大辰科技投资有限公司	159,071	25,891,986.67
12	北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金	106,051	17,261,921.27
13	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金	53,023	8,630,553.71
合计		1,272,570	207,136,218.90

（六）募集资金规模及用途

根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币

207,136,218.90元（已扣除财务性投资影响），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

公司将审议本次证券发行方案的董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额从本次募集资金总额中予以扣除，本次募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	扣减财务性投资后拟使用募集资金投入金额
1	宁波安集化学机械抛光液建设项目	11,950.00	11,950.00	11,950.00
2	安集科技上海金桥生产线自动化项目	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3	安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00
4	补充流动资金	6,050.00	6,050.00	2,763.62
合计		24,000.00	24,000.00	20,713.62

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

（七）限售期

本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（八）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润安排

本次发行完成后，本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发

行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

（十）本次发行决议的有效期

本次发行决议自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日内有效。

若法律、行政法规、规范性文件以及部门规章对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

四、本次发行是否构成关联交易

本次发行的对象为平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

五、本次发行不会导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，Anji Cayman持有公司28,144,459股股份，占公司股份总数的37.68%，为公司控股股东，公司无实际控制人。

根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为1,272,570股。本次发行完成后，公司控股股东Anji Cayman持股数量占公司总股本的37.04%，仍将保持控股股东的地位，且公司仍然无实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

六、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、本次发行符合以简易程序向特定对象发行股票并上市的条件

（一）本次发行符合《注册管理办法》第二十一条与二十八条关于适用简易程序的有关规定

发行人 2021 年年度股东大会已就本次发行的相关事项作出了决议，并授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，决议自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日内有效。

根据 2021 年年度股东大会的授权，发行人于 2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 12 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为 207,136,218.90 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

因此，本次发行符合《注册管理办法》第二十一条、第二十八条关于简易程序的相关规定。

（二）本次发行符合《注册管理办法》第六十六条关于有关方不得对发行对象做出保底保收益承诺或变相保底保收益承诺、提供财务资助或其他补偿的有关规定

本次以简易程序向特定对象发行，上市公司及其控股股东、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条的规定。

因此，本次发行符合《注册管理办法》第六十六条关于有关方不得对发行对象做出保底保收益承诺或变相保底保收益承诺、提供财务资助或其他补偿的有关规定。

（三）本次发行符合《审核规则》第三十四条、第三十五条有关简易程序的规定

1、本次发行不存在《审核规则》第三十四条规定不得适用简易程序的情形

发行人本次发行不存在《审核规则》第三十四条规定不得适用简易程序的情形：

“（1）上市公司股票被实施退市风险警示或者其他风险警示；

（2）上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚、最近一年受到中国证监会行政监管措施或者证券交易所纪律处分；

（3）本次发行上市申请的保荐人或者保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员最近一年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分。证券服务机构在各类行政许可事项中提供服务的行为按照同类业务处理，在非行政许可事项中提供服务的行为，不视为同类业务。”

因此，发行人不存在《审核规则》第三十四条规定不得适用简易程序的情形。

2、本次发行符合《审核规则》第三十五条关于适用简易程序的相关规定

本次发行符合《审核规则》第三十五条关于适用简易程序的相关规定：

“上市公司及其保荐人应当在上市公司年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向本所提交下列发行上市申请文件：

（一）募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件；

（二）上市保荐书；

（三）与发行对象签订的附生效条件股份认购合同；

（四）中国证监会或者本所要求的其他文件。

上市公司及其保荐人未在前款规定的时限内提交发行上市申请文件的，不再适用简易程序。

上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当在向

特定对象发行证券募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

保荐人应当在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确核查意见。”

根据 2021 年年度股东大会的授权，发行人于 2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 12 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜。

发行人及保荐人提交申请文件的时间在发行人年度股东大会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内。发行人及保荐人提交的申请文件包括：（1）募集说明书、发行保荐书、审计报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等注册申请文件；（2）上市保荐书；（3）与发行对象签订的附生效条件的股份认购合同；（4）中国证监会或者上交所要求的其他文件。

发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员已在本次发行募集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺。

保荐人已在发行保荐书、上市保荐书中，就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见。

因此，本次发行符合《审核规则》第三十五条关于适用简易程序的相关规定。

八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行已取得的授权和批准

2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，就本次发行证券种类和数量、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排、定价方式或者价格区间、募集资金用途、决议的有效期限、发行前的滚存利润安排、上市地点等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特

定对象发行股票有关的全部事宜。

根据 2021 年年度股东大会的授权，公司于 2022 年 12 月 1 日、2023 年 1 月 12 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议，审议通过了本次发行具体方案及其他发行相关事宜，同时审议并确认了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）本次发行尚需获得的授权、批准和核准

- 1、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过；
- 2、本次以简易程序向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币207,136,218.90元（已扣除财务性投资影响），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

公司将审议本次证券发行方案的董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额从本次募集资金总额中予以扣除，本次募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额	扣减财务性投资后拟使用募集资金投入金额
1	宁波安集化学机械抛光液建设项目	11,950.00	11,950.00	11,950.00
2	安集科技上海金桥生产线自动化项目	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3	安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00
4	补充流动资金	6,050.00	6,050.00	2,763.62
合计		24,000.00	24,000.00	20,713.62

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）宁波安集化学机械抛光液建设项目

1、项目概况

公司基于现有业务和核心技术平台，拟利用宁波市北仑区柴桥街道青山路79号的已建厂房，建设化学机械抛光液生产线，加强和保障公司化学机械抛光液板

块产品供应能力。本项目实施主体为公司全资子公司宁波安集微电子科技有限公司，计划投资11,950.00万元用于建设化学机械抛光液的生产系统和相应的厂务系统，包括投资建设洁净室，购置先进生产设备及配套仪器，引入与生产系统配套的空调、纯水、排水、用气、用电、仓储装修和自动化配套系统等。

本项目建成后将新增1.5万吨化学机械抛光液生产能力，以更好地应对和满足下游市场需求，提升公司产品稳定性和综合竞争力，有助于支持和保障国内集成电路产业链供应链安全稳定。

2、项目实施的必要性

（1）把握集成电路产业快速发展和化学机械抛光液国产替代的良好机遇

当前，全球半导体产业已进入5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等创新技术驱动的新增长阶段。根据WSTS统计，全球半导体产业销售额已从2000年的2,044亿美元增长至2021年的5,559亿美元，并从中国台湾、日本、韩国向中国大陆转移。根据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元，由2012年的2158.5亿元增长至2021年的10,458.3亿元，年均复合增长率近20%。

受益于全球半导体产业特别是中国集成电路产业快速增长，中国大陆半导体材料市场规模增速全球领先。根据SEMI，2021年全球半导体材料销售额为643亿美元，相较于2020年的555亿美元同比增长15.9%，其中晶圆制造材料和封装材料的销售额分别为404亿美元和239亿美元，同比增长率分别为15.5%和16.5%。从地区来看，2021年中国台湾凭借其强大的晶圆代工和先进封装基础，以147亿美元连续第十二年成为半导体材料的最大消费地区，增长率15.7%；中国大陆由于积极建厂，半导体材料市场销售额119亿美元，增长率21.9%，继续超越韩国位列第二。

化学机械抛光液是制造集成电路的关键材料，长期以来被美国和日本企业所垄断，公司成功打破了国外厂商的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。受益于国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商技术的突破和成熟、国产化的成本优势等，未来集成电路领域化学机械抛光液存在较大的国产替代空间，有望进一步降低进口依赖。此外，由于半导体产业具有明显的技

术驱动特征，下游集成电路制造和封测企业在制程技术上的突破和新材料、新工艺的引进，对化学机械抛光液等关键半导体材料提出了更高的要求，也给包括公司在内的半导体材料供应商带来了发展机遇。因此，公司亟需通过实施本次募投项目增加生产能力，及时把握集成电路产业快速发展和抛光液国产替代的良好机遇。

（2）打造公司化学机械抛光液第二生产基地，加强和保障产品供应能力，实现区域协调发展

公司现有两个生产制造基地，分别位于上海市浦东新区金桥综合保税区和浙江省宁波市北仑区。其中，上海金桥基地主要生产化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品，宁波北仑基地主要生产功能性湿电子化学品。

2020年初国内外爆发了新冠疫情对全球经济发展和国内外企业生产经营造成了一定不利影响。2022年上半年度，在上海市新冠疫情反复的形势下，公司快速组织金桥基地实行生产厂区闭环管理，秉承“保生产、保供应物流、保员工安全”的“三保”原则，克服疫情带来的重重挑战，保障了生产供应的正常运转，完成了疫情防控期间产品的全面及时交付。

面对新冠疫情发展的不确定性、全球政治环境不稳定以及全球供应链紧张等环境因素，公司拟在宁波北仑基地新建化学机械抛光液生产线，打造公司化学机械抛光液第二生产基地，加强和保障产品供应能力，实现区域协调发展，同时满足客户关于供应商应设立多个生产基地以规避风险的要求，对于确保产业链供应链稳定具有重要意义。

3、项目实施的可行性

（1）国家及地方政府大力支持集成电路材料产业的发展

化学机械抛光液作为应用于集成电路领域的关键材料，属于国家重点鼓励、支持的战略性新兴产业。当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期，为了加快推进我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、本土化供应的进程，国家及地方制定了一系列产业政策，对于提升中国集成电路产业链关键配套材料的本土供应能力起到了重要作用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，聚焦新

一代信息技术等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能；在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程，瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。国家对集成电路产业发展的高度重视为我国半导体材料产业持续发展创造了良好的政策环境。

在地方政策层面，作为浙江省乃至全国集成电路重要的制造基地，宁波形成了涵盖材料企业、设计企业、制造企业、封装测试企业、设备及服务企业、应用企业的集成电路完整产业链，并与上海等地之间形成了产业共建体系。宁波当地政府对集成电路产业链的高度重视和政策支持将有助于本次募投项目的顺利实施。

（2）公司打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断，已具备丰富的产品开发及量产经验

公司自成立之初就将自己定位为高端半导体材料领域的一站式合作伙伴，率先选择技术难度高、研发难度大的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，并持续专注投入，已成功打破了国外厂商的垄断并已成为众多半导体行业领先客户的主流供应商。在化学机械抛光液板块，公司致力于实现全品类产品线的布局和覆盖，旨在为客户提供完整的一站式解决方案。

在产品开发及量产经验方面，公司化学机械抛光液产品已涵盖铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液五大产品平台。同时，公司还基于化学机械抛光液技术和产品平台，支持客户对于不同制程的需求，定制开发用于新材料、新工艺的化学机械抛光液。2019年度、2020年度和2021年度，公司化学机械抛光液板块实现营业收入分别为23,570.31万元、37,491.12万元和59,403.47万元，复合增长率达到58.75%，多款抛光液产品持续扩大市场份额，客户数量和产品用量增长稳定。

（3）半导体材料市场前景广阔，公司与行业领先客户合作，多款产品开发进展顺利，为募投项目产能消化提供了市场保障

半导体材料市场规模与半导体市场规模同步增长，且制造更先进技术节点的逻辑芯片、3D存储芯片架构和异构集成技术需要更多的工艺步骤，带来更高的

晶圆制造材料和封装材料消耗需求。同时，半导体芯片领域化学机械抛光液行业特点是准入门槛高、认证时间长，一旦成为下游集成电路领域客户的合格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系。

公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在纵向不断提升技术与产品能力的同时横向拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。公司持续加强研发投入，与行业领先客户合作，进一步了解客户需求，并为其开发创新性的整体解决方案。在化学机械抛光液板块，公司铜及铜阻挡层抛光液的成熟产品在多家新建芯片制造厂作为首选打入客户端并准备量产，多款产品在逻辑芯片和存储芯片领域持续上量，在先进制程上持续验证，拓宽应用领域；氮化硅抛光液通过客户验证并实现量产销售，使国内具备氮化硅抛光液产品自主供应能力，同时也进一步提升了公司的介电材料抛光液产品平台的竞争力；钨抛光液在逻辑芯片技术节点通过验证并实现销售，多个产品在不同的客户和技术节点进行测试验证，进展顺利；基于氧化铈磨料的抛光液在国内领先的存储客户持续突破，多款新产品完成论证测试并实现量产销售；衬底抛光液产品平台发展快速，硅精抛液取得突破，技术性能达到国际先进水平，并在国内领先硅片生产厂完成论证并实现量产，部分产品已获得中国台湾客户的订单；为客户定制开发的用于第三代半导体衬底材料的抛光液，部分产品已获得海外客户的订单。公司现有优质客户资源以及多款产品开发进展顺利，为募投项目产品的市场推广和客户导入提供了有力支撑。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为公司全资子公司宁波安集，项目总投资11,950.00万元，投资概算如下：

序号	项目	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	厂务系统及配套	5,500.00	是	5,500.00
2	设备及安装	5,300.00	是	5,300.00
3	预备费	540.00	否	540.00
4	铺底流动资金	610.00	否	610.00
合计		11,950.00	-	11,950.00

5、项目选址和建设期限

公司拟利用宁波市北仑区柴桥街道青山路79号的已建厂房实施本项目，宁波安集已取得浙（2020）北仑区不动产权第0033575号不动产权证，用途为“工业用地/工业用房”。

本项目预计建设期为2年，具体实施进度计划如下表所示：

项目	建设期第1年				建设期第2年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设计、招标及厂务等建设								
生产线和实验室配套仪器采购、安装及调试								
仓库装修和自动化配套系统等建设								

6、项目经济效益

本项目税后内部收益率为20.22%，静态投资回收期为7.99年。

本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入预测

本项目拟新增化学机械抛光液产能，营业收入= \sum 销量 \times 单价。本项目预计于第3年开始投产，投产后第二年产能利用率为28.57%，第三年为63.84%，第四年为79.97%，投产后第9年达到满产，项目投产到达产期间，产能逐渐爬升。销量根据目标客户各年用量预测，销售单价参考公司各品类化学机械抛光液定价原则及趋势确定。

（2）税金及附加预测

本项目销项税按营业收入的13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的13%估算，增值税为销项税与进项税之差；城市维护建设税按照应缴纳增值税的7%估算；教育费附加按照应缴纳增值税的3%估算，地方教育费附加按照应缴纳增值税的2%估算；本项目效益测算期为10年，自项目公司实现盈利第4年开始按照25%的税率估算企业所得税。

（3）总成本费用预测

本项目总成本费用包括原辅材料费、燃料动力费、固定资产折旧、摊销、职

工薪酬、其他费用等。

1) 原辅材料费和燃料动力费：本项目外购原辅材料和燃料动力费根据生产预计所需前述成本占收入的比例确定。

2) 固定资产折旧：本项目采用分类直线折旧方法计算。新增机器设备折旧年限取10年，均无残值。

3) 职工薪酬：本项目新增定员包括管理人员、生产人员、技术人员和仓库人员等，薪酬结合公司的薪酬福利制度及项目建设当地各类员工的工资水平确定。

4) 其他费用：本项目其他费用主要包括其他制造费用和其他期间费用（不包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并结合项目公司实际经营情况予以确定。

7、项目备案和环评情况

本项目已取得北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》，已取得宁波市生态环境局出具的《关于宁波安集电子科技有限公司宁波安集化学机械抛光液建设项目环境影响报告书的批复》。

（二）安集科技上海金桥生产线自动化项目

1、项目概况

本项目拟在公司上海金桥基地搭建MES（制造执行系统）、DCS（集散控制系统）等生产控制类系统，旨在提高公司生产线的自动化程度，进一步提升公司生产效率和工艺水平，增强公司规模化生产能力。

2、项目实施的必要性

（1）“工业4.0”大趋势下，传统制造业向智能生产、智能制造转型升级

“工业4.0”是以智能制造为主导的第四次工业革命，是制造业与新一代信息技术深度融合的智能化的时代性变革技术。它是通过将信息技术与操作技术相结合，通过物联网设备、网络物理系统和人工智能算法来驱动的智能基础设施来优化生产流程，从而显著提高生产力。

智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。目前，我国已经发展成为全球制造业大国，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，但基础制造水平还有较大的提升空间，发展智能制造对于巩固实体经济根基、建成现代产业体系、实现新型工业化具有重要作用。因此，跟随全球工业4.0的发展步伐，通过智能制造加快我国传统制造业的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，也将成为我国工业化进程的必然选择。

（2）进一步提升公司生产线自动化和智能化水平，增强综合竞争力

随着公司生产规模的不断扩大，进一步提高生产线自动化水平变得日趋重要。MES和DCS是重要的生产控制类系统，通过在公司现有厂区搭建该类系统，增加对生产过程的管控，将实现从生产计划下达到生产调度、组织、执行、控制直至生产出合格产品全过程的信息化管理，并实现对生产过程的自动控制和监视管理，进一步提升公司生产线自动化和智能化水平，增强公司的综合竞争力。

3、项目实施的可行性

（1）推进生产过程智能化及智能制造受到国家产业政策的积极推动

《中国制造2025》指出加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。2021年12月，工业和信息化部等八部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》，指出“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

（2）公司良好的信息化建设基础为项目顺利建设提供保障

公司自成立以来一贯注重信息化建设，设置了信息技术部门和团队，已逐步在财务管理、供应链管理、研发管理等生产运营环节建立信息系统。本次募投项目侧重于MES和DCS等生产控制类系统，建成后将实现公司信息系统和生产类控

制系统之间的互补、融合，进一步提高公司整体管控水平和经营效率。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为公司，项目总投资4,500.00万元，投资概算如下：

序号	项目	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	MES 系统	1,400.00	是	1,400.00
2	DCS 系统	1,000.00	是	1,000.00
3	QMS 系统和 SPC 系统	300.00	是	300.00
4	LIMS 系统	200.00	是	200.00
5	弱电和机房服务器	800.00	是	800.00
6	其他仪器仪表更新改造	500.00	是	500.00
7	其他配套	300.00	是	300.00
合计		4,500.00	-	4,500.00

5、项目选址和建设期限

公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路356号的租赁房屋实施本项目。

本项目预计建设期为3年，具体实施进度计划如下表所示：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
弱电、机房服务器建设及其他配套更新改造	■	■	■	■								
LIMS（实验室管理系统）设计、招标、实施及上线		■	■	■		■	■					
DCS（集散控制系统）设计、招标、实施及上线						■	■	■	■			
MES（制造执行系统）设计、招标、实施及上线						■	■	■	■			
SPC（统计过程控制系统）和 QMS（质量管理系统）等设计、招标、实施及上线									■	■	■	■

6、项目经济效益

本项目旨在提高公司生产线的自动化程度，不直接产生效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

7、项目备案和环评情况

本项目已取得上海金桥经济技术开发区管委会出具的《上海市外商投资项目备案证明》。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021年版）》规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。

（三）安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目

1、项目概况

本项目拟在公司上海金桥基地购置各类分析检测仪器，旨在提升公司分析检测能力，进一步加强公司产品质量控制，并为公司持续科技创新提供重要支撑。

2、项目实施的必要性

（1）提升分析检测能力是进行质量控制的必要手段

公司主要产品化学机械抛光液和功能性湿电子化学品属于配方型产品，在产品配方开发及产业化过程中，需筛选出合适的原材料进行复配，并确定合适的添加比例，涉及反复、大量的实验、测试、检验分析等流程。通过分析检测各种物料的组成及含量，是公司产品生产过程中进行质量控制的必要手段，从而保证原材料及产品的质量符合相应的标准并进入下一步工序。

公司在原材料采购、产品生产、质量检测等生产经营的各个环节已制定并实施了较为完备的质量控制程序，通过购置先进的分析检测类仪器，可以有效提升公司分析检测能力，进而加强公司产品质量管控，保障公司高质量发展。

（2）进一步提升公司技术水平和科技创新能力

集成电路领域高端半导体材料对产品配方及生产工艺流程控制要求更高，对产品及原材料的分析检测能力要求也更高。公司的核心技术涵盖了整个产品配方和工艺流程，各类分析检测仪器在公司核心技术创新及产业化过程中起着重要作用。通过本次募投项目的实施可以进一步完善公司分析检测平台，支撑公司生产过程中的质检和检测需求，有助于提高公司的技术水平和科技创新能力。

3、项目实施的可行性

（1）国家鼓励支持提升产品质量

《中国制造2025》指出要加快提升产品质量，实施工业产品质量提升行动计划，针对关键原材料等重点行业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用，推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等，使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。2022年11月，市场监管总局等18部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》，指出强化材料质量保障能力，实施新材料标准领航行动和计量测试能力提升工程，加快先进半导体材料和碳纤维及其复合材料的标准研制，加强新材料制备关键技术攻关和设备研发。

（2）公司深厚的技术储备和优秀的人才队伍保障项目的顺利实施

公司自成立以来先后承担了多个科研项目，实现了多项关键技术突破，掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，涵盖了整个产品配方和工艺流程，成熟并广泛应用于公司产品的批量生产中。公司持续投入大量的资金、人力等研发资源，将研发重点聚焦在产品创新上，以满足下游集成电路制造和先进封装行业全球领先客户的尖端产品应用。同时，公司利用在化学配方、材料科学等领域的专长，持续研发创新产品或改进产品以满足下游技术先进客户的需求，将客户面临的具体挑战转化成现实的产品和可行的工艺解决方案。得益于有竞争力的商业模式，公司产品研发效率高且具有针对性，产品转化率高。深厚的技术积累、持续的研发投入、高效的产品转化为项目的实施提供了技术支撑。

此外，公司作为技术密集型企业，高度重视研发团队的培养，已经建立起一支具备扎实专业功底、丰富技术经验的研发团队。公司核心技术团队在半导体材料行业积累了数十年的丰富经验和先进技术，为项目的实施提供了人才基础。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为公司，项目总投资1,500.00万元，投资概算如下：

序号	项目	投资金额（万元）	是否属于资本性支出	拟使用募集资金投入金额（万元）
1	分析检测类设备	1,332.40	是	1,332.40
2	安装调试费	167.60	是	167.60
合计		1,500.00	-	1,500.00

5、项目选址和建设期限

公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路356号的租赁房屋实施本项目。

本项目预计建设期为3年，具体实施进度计划如下表所示：

项目	建设期第1年				建设期第2年				建设期第3年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
颗粒测试仪、纳米粒径测试仪等采购、安装及调试												
质谱仪、分析仪等采购、安装及调试												
色谱仪、离子色谱系统等采购、安装及调试												

6、项目经济效益

本项目旨在提升公司分析检测能力，不直接产生效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

7、项目备案和环评情况

本项目已取得上海金桥经济技术开发区管委会出具的《上海市外商投资项目备案证明》。本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021年版）》规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理环评手续。

（四）补充流动资金

1、项目概况

公司本次发行拟使用募集资金2,763.62万元用于补充流动资金，以优化财务结构，降低流动性风险，满足公司未来生产经营发展的资金需求。

2、补充流动资金的必要性分析

（1）公司经营规模增长将增加日常营运资金需求

2019年度、2020年度和2021年度，公司经营规模持续扩大，实现营业收入分别为28,541.02万元、42,237.99万元和68,666.06万元，复合增长率达到55.11%。随着营业收入规模的增长，公司存货和应收账款规模均同步增长，对营运资金的需求

求不断增加，保证营运资金充足对于抵御市场风险、提高竞争力和实现战略规划具有重要意义。

本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来的资金压力，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施，促进公司可持续发展。

（2）优化公司财务结构，增强公司抗风险能力

2019年末、2020年末和2021年末，公司的负债总额分别为10,362.93万元、23,924.16万元和47,106.75万元，资产负债率分别为10.45%、18.58%和28.17%。本次募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构，增强公司抗风险能力，促进公司持续、稳定、健康发展。

3、补充流动资金的可行性分析

（1）本次募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

公司本次募集资金部分用于补充流动资金符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，具有可行性。

（2）公司内部治理规范，内控制度完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制订了《募集资金管理使用制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中管理，专款专用，规范使用募集资金。

4、本次募集资金中资本性支出、非资本性支出构成以及补充流动资金占募集资金的比例

公司本次以简易程序向特定对象发行股票发行对象拟认购金额合计为人民币207,136,218.90元，其中宁波安集化学机械抛光液建设项目拟使用募集资金11,950.00万元（其中预备费540.00万元、铺底流动资金610.00万元），安集科技上海金桥生产线自动化项目拟使用募集资金4,500.00万元，安集科技上海金桥生

产基地分析检测能力提升项目拟使用募集资金1,500.00万元，补充流动资金项目拟使用募集资金2,763.62万元。宁波安集化学机械抛光液建设项目非资本性支出与补充流动资金合计占募集资金总额的比例为18.89%，未超过拟募集资金总额的30%。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于加强和保障公司产品供应能力，提升公司生产效率和检测能力，并以此助推公司业务的进一步发展，巩固和提升公司的竞争优势，符合公司及股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，公司综合实力和竞争力将进一步增强，有利于公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司产品作为新一代信息技术产业用材料，属于战略性新兴产业中新一代信息技术产业和新材料产业的交叉领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“1新一代信息技术产业——1.2电子核心产业——1.2.3高储能和关键电子材料制造（C3985电子专用材料制造）”和“3新材料产业——3.3先进石化化工新材料——3.3.6专用化学品及材料制造（C3985电子专用材料制造）”。

本次募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，其中“宁波安集化学机械抛光液建设项目”为公司现有主营业务的扩产，建成后将新增1.5万吨化学机械抛光液生产能力，并打造公司化学机械抛光液第二生产基地，有利于加强和保障产品供应能力，支持和保障国内集成电路产业链供应链安全稳定；“安集科技上海金桥生产线自动化项目”旨在通过搭建先进的生产控制类系统，提高公司生产线的自动化程度，进一步提升公司生产效率和工艺水平，增强公司规模化生产能力；“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”旨在通过购置各类先进的分析检测类仪器，完善公司分析检测平台，支撑公司生产过程中的质检和检测需求，进一步加强公司产品质量稳定性和市场竞争力；“补充流动资金”项目主要用于满足公司未来生产经营发展的资金需求，为公司持续保持科技创新实力提供重要支撑。本次募集资金未直接或变相用于类金融业务。

本次募投项目实施后生产的产品主要为集成电路领域化学机械抛光液，不涉及《环境保护综合名录（2021年版）》中规定的高污染、高环境风险产品。

（二）本次募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

通过本次募投项目的实施，公司将进一步提升主要产品化学机械抛光液的生产能力，提高公司的生产效率和工艺水平，增强公司的分析检测能力，有助于增强公司的综合竞争实力和核心技术及业务优势，进一步促进公司科技创新水平的提升，为公司实现成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。

未来，公司将凭借在高端半导体材料领域积累的宝贵经验持续深耕，助力国内半导体制造用关键材料自主可控供应能力的提升。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。本次募集资金投资项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”为公司现有主营业务的扩产，建成后将新增1.5万吨化学机械抛光液生产能力，并打造公司化学机械抛光液第二生产基地，有利于加强和保障产品供应能力，支持和保障国内集成电路产业链供应链安全稳定；“安集科技上海金桥生产线自动化项目”旨在通过搭建先进的生产控制类系统，提高公司生产线的自动化程度，进一步提升公司生产效率和工艺水平，增强公司规模化生产能力；“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”旨在通过购置各类先进的分析检测类仪器，完善公司分析检测平台，支撑公司生产过程中的质检和检测需求，进一步加强公司产品质量稳定性和市场竞争力；“补充流动资金”项目主要用于满足公司未来生产经营发展的资金需求，为公司持续保持科技创新实力提供重要支撑。

本次募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

二、本次发行完成后，公司控制权结构的变化

截至本募集说明书签署日，Anji Cayman持有公司28,144,459股股份，占公司股份总数的37.68%，为公司控股股东，公司无实际控制人。

根据本次发行竞价结果，本次发行的股票数量为1,272,570股。本次发行完成后，公司控股股东Anji Cayman持股数量占公司总股本的37.04%，仍将保持控股股东的地位，且公司仍然无实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

三、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

本次发行对象为平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金。

本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人不存在关联交易情况。

公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

五、本次发行完成后，公司科研创新能力的变化

本次发行募集资金投资项目紧密围绕科技创新领域和公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展趋势和公司整体发展战略，募集资金投向属于科技创新领域。本次发行完成后，随着本次募集资金投资项目的顺利实施，公司科技创新水平将进一步提升。

第五节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票13,277,095股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币39.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币520,329,353.05元，扣除总发行费用人民币45,437,451.25元，实际募集资金净额为人民币474,891,901.80元，实际到账金额为人民币483,927,759.01元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月17日出具了毕马威华振验字第1900382号验资报告。

（二）募集资金专户存放情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司与首次公开发行股票的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议。

1、募集资金使用情况

截至2022年9月30日，公司的募集资金余额为人民币207,539,020.08元。具体情况如下表：

单位：元

项目	金额
实际收到募集资金	483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额	287,555,012.04
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	11,275,870.74
使用募集账户支付的募投项目款	225,587,263.60

项目	金额
减：超募资金永久补充流动资金	48,428,548.77
减：节余募集资金永久补充流动资金	2,263,328.93
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
减：支付的其他发行费用	5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	20,202,130.32
截至 2022 年 9 月 30 日募集资金余额	207,539,020.08

2、募集资金存放专户存款余额情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：元

银行名称	募集资金专户账号	初始存放金额	余额
招商银行上海天山支行	121908362710905	120,000,000.00	68,430,211.43
平安银行上海自贸试验区分行	15842191613100	94,100,000.00	已注销
	15663715975369	-	已注销
建设银行上海金桥支行	31050161373609588888	20,000,000.00	13,313,068.91
	31050161373609577777	69,000,000.00	9,525,712.56
	31050161373609566666	-	3,242,563.68
中信银行上海五牛城支行	8110201013401034448	180,827,759.01	78,027,463.50
合计		483,927,759.01	172,539,020.08

注：募集资金专户账号 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，截至 2022 年 9 月 30 日，结构性存款余额如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中信银行上海五牛城支行	中信银行结构性存款 C22RR0101	结构性存款	3,500.00	2022-10-08	3.01%	37 天
合计		-	3,500.00	-	-	-

二、前次募集资金投资项目情况说明

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金的具体使用情况如下，除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。

前次募集资金使用情况对照表（截至 2022 年 9 月 30 日）

单位：元

募集资金净额：			474,891,901.80			已累计使用募集资金总额：			287,555,012.04	
						各期间使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			-			2019 年度：			23,154,525.23	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020 年度：			65,612,319.68	
						2021 年度：			143,446,847.09	
						2022 年 1-9 月期间：			55,341,320.04	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目	安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目	120,000,000.00	120,000,000.00	58,989,875.31	120,000,000.00	120,000,000.00	58,989,875.31	-61,010,124.69	2023 年 7 月[注 2]
2	安集集成电路材料基地项目	安集集成电路材料基地项目	94,100,000.00	94,100,000.00	92,943,860.71	94,100,000.00	94,100,000.00	92,943,860.71	-1,156,139.29	2021 年 12 月
		节余募集资金永久补充流动资金	不适用	2,263,328.93	2,263,328.93	不适用	2,263,328.93	2,263,328.93	-	不适用
3	安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	69,000,000.00	69,000,000.00	57,056,074.25	69,000,000.00	69,000,000.00	57,056,074.25	-11,943,925.75	2023 年 7 月[注 2]

4	安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	20,000,000.00	20,000,000.00	7,031,359.00	20,000,000.00	20,000,000.00	7,031,359.00	-12,968,641.00	2023年7月[注2]
5	超募资金	安集微电子科技（上海）股份有限公司研发中心扩大升级项目	不适用	130,000,000.00	20,841,965.07	不适用	130,000,000.00	20,841,965.07	-109,158,034.93	2024年5月
6		永久补充流动资金		48,428,548.77	48,428,548.77		48,428,548.77	48,428,548.77	-	不适用
合计			303,100,000.00	483,791,877.70 [注1]	287,555,012.04	303,100,000.00	483,791,877.70 [注1]	287,555,012.04	-196,236,865.66	—

注1：募集后承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益以及安集集成电路材料基地项目节余募集资金永久补充流动资金的金额含募集资金利息收入。

注2：公司于2021年8月25日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目”、“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”的建设期延长至2023年7月。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2020年9月15日公司召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，同意“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”实施地点由原来的上海市浦东新区碧波路889号E座1层调整为上海市浦东新区。

2021年4月28日公司召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意“安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目”实施地点由原来的上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6-8、T6-9、T6-10、T6-11幢底层厂房变更为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6号地块。

2021年8月25日公司召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”新增安集微电子科技（上海）股份有限公司为该项目的实施主体；同意将募投项目“安集微电子科技（上海）股份有限公司CMP抛光液生产线扩建项目”、“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”的建设期延长至2023年7月。除此之外募集投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2019年10月28日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11,275,870.74元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币3,335,522.68元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第1901009号）。截至2019年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

2019年8月20日，公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2020年4月20日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2021年3月30日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2022年4月13日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币38,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至2022年9月30日，除“一、最近五年内募集资金运用的基本情况”中的结构性存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

（五）用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 13,000 万元用于研发中心扩大升级项目。

（六）用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 48,428,548.77 元（含利息）永久补充公司流动资金，主要用于原材料采购、市场开拓及日常经营活动等与主营业务相关的生产经营，不直接或间接投资与主营业务无关的公司。

（七）用节余募集资金永久补充流动资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币 2,263,328.93 元永久补充流动资金，并于 2022 年 2 月完成了该项目两个募集资金专户的注销。

（八）尚未使用完毕募集资金的情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为人民币 207,539,020.08 元（含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额），占前次募集资金净额的比例为 43.70%。除“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项外，其他前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，剩余募集资金将继续用于前次募集资金投资项目支出。

（九）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2022 年 9 月 30 日）

单位：吨

实际投资项目		截至 2022 年 9 月 30 日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益 [注 1]
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目 [注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	安集集成电路材料基地项目 [注 3]	20.79%	不适用	不适用	不适用	不适用	225.45	225.45	不适用
3	安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	安集微电子科技（上海）股份有限公司研发中心扩大升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司未对募投项目的效益做出承诺。

注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目尚未达到预定可使用状态，公司将按照计划有序推进募投项目的资金投入。

注 3：安集集成电路材料基地项目已于 2021 年 12 月建设完毕并达到预定可使用状态。截至 2022 年 9 月 30 日，该项目实现功能性湿电子化学品产量 225.45 吨，该数据未经审计。

（十）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（十一）前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

（十二）前次募集资金使用情况的信息披露对照情况

公司上述募集资金的实际使用情况与公司其他信息披露文件中所披露的有关内容一致。

三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

公司 2019 年首次公开发行股票的募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务及科技创新领域展开，包括公司 CMP 抛光液生产线扩建项目、安集集成电路材料基地项目、安集微电子集成电路材料研发中心建设项目、公司信息系统升级项目及使用部分超募资金用于公司研发中心扩大升级项目、使用部分超募资金永久补充流动资金。公司 CMP 抛光液生产线扩建项目、安集集成电路材料基地项目是对公司现有产品品类的升级和产能扩充；安集微电子集成电路材料研发中心建设项目、公司研发中心扩大升级项目有利于完善公司研发体系，提升公司自主创新能力和研发实力，为公司主营业务发展提供更多技术支撑；公司信息系统升级项目、补充流动资金有利于提升公司运营效率，保障了公司对研发和创新的资金支持，进一步提升公司综合竞争力和抗风险能力。

四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论

2022 年 12 月 1 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2022 年 9 月 30 日募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201657 号），鉴证结论为：“我们认为，安集科技前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了安集科技前次募集资金截至 2022 年 9 月 30 日止的使用情况”。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、技术风险

（一）产品开发风险

公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于产品技术创新要求较高。在下游产品不断提出更高技术要求的前提下，对上游关键半导体材料的要求也在不断提高，公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发满足客户需求的产品。如果公司未来不能准确地把握技术发展趋势，在产品开发方向上的战略决策上出现失误，或者未能及时进行产品升级和新技术的运用，将使得公司产品开发的成功率受到影响，持续大量的研发投入成本无法回收，进而对公司经营造成不利影响。

（二）核心技术失密风险

公司核心技术涵盖了整个产品配方和工艺流程，对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司在化学机械抛光液和功能性湿电子化学品市场的竞争力至关重要。如果因个别人员保管不善、工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术失密，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

（三）核心技术人员流失的风险

核心技术人员对公司持续科技创新及客户技术支持服务至关重要。如果公司无法保留和吸引优秀人才，或者公司优秀人才加盟竞争对手或成立竞争公司，可能会导致公司的客户、技术流失，进而对公司的发展前景产生不利影响。

二、经营风险

（一）客户集中度较高风险

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司向前五名客户合计的销售总额占当期销售总额的百分比分别为84.74%、84.99%、84.45%和82.19%。公司销售较为集中的主要原因系国内外集成电路制造行业本身集中度较高、公司产品定位领先技术的特点和“本土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司

主要客户均为国内外领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者主要客户因各种原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调产品价格，公司的经营业绩可能出现下降。

（二）半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长，全球半导体特别是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的刺激下，获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关，如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑，将对公司经营业绩产生不利影响。

（三）市场竞争风险

公司经过多年以来的技术积累、品牌建设，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。目前公司的竞争对手主要为美国和日本企业，如果竞争对手开发出更具有竞争力的产品、提供更好的价格或服务，或者竞争对手获得特定的知识产权，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

（四）原材料供应及价格上涨风险

硅溶胶和气相二氧化硅等研磨颗粒为公司生产化学机械抛光液所需的重要原材料，主要直接或间接从日本等国家进口。2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比分别为50.71%、53.21%、51.27%和54.10%，采购相对集中。如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应中断等，或者进出口政策出现重大变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国采取出口管制，或者公司主要原材料价格受市场影响出现上升，将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外，公司主要从上游基础化工或精细化工行业采购原材料，随着环保政策趋严，供应趋紧，原材料价格可能存在上涨的风险。

（五）安全环保风险

报告期内，公司严格按照《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》等有关规定进行危险化学品的日常管理。如果公司在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故，将会对公司的生产经营带来不利影响。

公司产品的生产工艺主要为配方型复配工艺，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。如果发生因环保设施故障、污染物外泄等原因导致的环保事故，将对公司的生产经营产生不利影响。

（六）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险

当前全球经济处于周期性波动当中，叠加新冠疫情、全球政治环境不稳定等因素的影响，尚未出现经济全面复苏的趋势，面临下滑的可能。随着全球主要经济体经济增速放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下游客户需求或者订单量产生不利波动，进而影响公司业绩。此外，如果发生自然灾害、战争或其他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下游市场及公司经营业绩造成影响。

三、财务风险

（一）毛利率下降风险

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司综合毛利率分别为50.25%、52.03%、51.08%和52.63%，略有波动。由于公司综合毛利率对销售价格、产品结构、原材料成本等因素的变化较为敏感，如果未来行业竞争加剧等可能导致产品价格下降，或者公司未能有效控制成本，可能导致公司综合毛利率下降，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

（二）净资产收益率下降的风险

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为7.45%、6.09%、8.10%和17.31%。本次发行募集资金到位后，公司净资产和股本总额较发行前有所增加，而本次募集资金

拟投资项目的实施和达产需要一定时间，因此本次发行后公司净资产收益率存在进一步下降的风险。

（三）汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料中使用美元结算的比例较大。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，受人民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损益的金额分别为-141.60 万元、732.97 万元、580.71 万元和-3,997.34 万元。随着生产、销售规模的扩大，公司外汇结算量将继续增大。如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格仍将直接受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。

（四）税收优惠风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司税收优惠金额分别为 1,207.56 万元、2,637.70 万元、3,304.56 万元和 3,800.10 万元，占利润总额的比例分别为 16.46%、15.32%、25.02%和 16.26%。如果国家有关高新技术企业等税收优惠的法律、法规、政策发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法获得税收优惠，将对公司经营业绩造成不利影响。

（五）政府补助政策风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司计入其他收益的政府补助分别为 2,733.93 万元、1,662.94 万元、2,647.34 万元和 531.51 万元，占利润总额的比例分别为 37.27%、9.66%、20.05%和 2.27%。如果未来政府部门对相关产业的政策支持力度减弱，或者其他补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助将会减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）存货管理风险

2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，公司采用上线结算方式的主要客户收入占比分别为 65.69%、51.40%、78.17%和 73.14%。公司根据客户需求将货物发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 9 月末，公司发出商品账面余额分别为 685.82 万元、919.71 万元、3,626.81 万元和 5,144.97 万元，占存货账面余额的比例分别为 8.87%、

8.68%、15.66%和 16.54%。公司已与采用上线结算方式的客户约定发出商品的管理机制和保管、灭失等风险承担机制，但若双方对保管责任的界定不一致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品面临减值的风险。

（七）交易性金融资产公允价值变动风险

青岛聚源系公司于 2020 年以自有资金认缴出资 1 亿元与其他投资方共同设立，作为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发行的股票，公司将持有青岛聚源的合伙份额在报告期末按公允价值计入交易性金融资产，具体金额受中芯国际股价波动影响。2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-9 月，青岛聚源合伙份额相关交易性金融资产产生的公允价值变动损益金额分别为 8,724.30 万元、69.28 万元和-3,276.45 万元。如果未来公司对外投资的交易性金融资产的公允价值产生波动，将会对公司的经营业绩产生影响。

四、控股股东控制及无实际控制人的风险

本次发行前，公司控股股东 Anji Cayman 直接持有公司 37.68%的股份。本次发行后，Anji Cayman 仍处于控股地位。如果 Anji Cayman 利用其控股地位，对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，可能会损害公司及其他股东的利益，使公司面临大股东控制的风险。

由于公司无实际控制人，存在决策效率较低的风险。此外，由于公司无实际控制人，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司或公司控股股东被收购会导致公司控制权发生变化，可能会对公司业务发展方向和经营管理产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

五、募集资金投资项目相关风险

（一）募投项目实施风险

公司本次发行募集资金拟用于宁波安集化学机械抛光液建设项目、安集科技上海金桥生产线自动化项目、安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目和补充流动资金。

公司募投项目的实施对公司人力资源管理、资源配置、市场拓展和法律及财务风险管理等各方面能力提出了较高要求。虽然公司已在半导体材料领域积累了

丰富的经验，且对本次募集资金投资项目进行了审慎的可行性研究论证，但公司所处行业市场环境变化、产业政策变动、产品技术变革、公司项目管理及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响，公司存在募集资金投资项目无法实现预期收益、公司利润水平下降的风险。

（二）募投项目新增产能消化的风险

宁波安集化学机械抛光液建设项目建成后将新增 1.5 万吨化学机械抛光液生产能力，具体产品的销售情况受下游客户相应工艺产能及产量影响。如果募投项目投产后，公司下游客户需求发生不利变化，可能导致公司无法有效开拓市场以消化募投项目新增产能，进而导致募投项目无法实现预期收益。

（三）募投项目新增固定资产折旧导致利润下滑的风险

本次募集资金拟投资项目建成后，公司固定资产将有所增加，导致折旧费用相应增加。如果行业环境或市场需求环境发生重大不利变化，募集资金投资项目无法实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

六、本次发行相关风险

（一）审批风险

本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定。本次发行能否获得上交所审核通过或中国证监会同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间，均存在不确定性。

（二）发行风险

本次发行方案为向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、二级市场公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内外部因素的影响。

此外，不排除因市场环境变化、根据相关规定或监管要求而修改方案等因素的影响，导致原股份认购合同无法顺利履行的可能，本次发行方案可能因此变更或终止。因此，本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险。

（三）股票即期回报摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而本次募集资金投资项目的实施具有一定周期。根据公司测算，本次向特定对象发行股票可能导致公司每股收益被摊薄，公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

第七节 与本次发行相关的声明


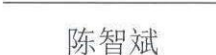

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

		
Shumin Wang (王淑敏)	Chris Chang Yu (俞昌)	朱沛文
		
杨磊	郝一阳	张天西
		
李华	任亦樵	

全体监事签名：

		
高琦	陈智斌	冯倩

高级管理人员签名：

		
Shumin Wang (王淑敏)	Zhang Ming (张明)	Yuchun Wang (王雨春)
		
杨逊		

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2023年2月22日



第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

	<i>Chris Chang Yu</i>	
Shumin Wang (王淑敏)	Chris Chang Yu (俞 昌)	朱沛文
杨 磊	郝一阳	张天西
李 华	任亦樵	

全体监事签名：

高 琦	陈智斌	冯 倩

高级管理人员签名：

Shumin Wang (王淑敏)	Zhang Ming (张 明)	Yuchun Wang (王雨春)
杨 逊		

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2023年2月22日



第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

		朱沛文
Shumin Wang (王淑敏)	Chris Chang Yu (俞昌)	朱沛文
杨磊	郝一阳	张天西
李华	任亦樵	

全体监事签名：

高琦	陈智斌	冯倩

高级管理人员签名：

Shumin Wang (王淑敏)	Zhang Ming (张明)	Yuchun Wang (王雨春)
杨逊		

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023年2月22日



第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

_____	_____	_____
Shumin Wang (王淑敏)	Chris Chang Yu (俞 昌)	朱沛文
		
杨 磊	郝一阳	张天西
_____	_____	
李 华	任亦樵	

全体监事签名：

_____	_____	_____
高 琦	陈智斌	冯 倩

高级管理人员签名：

_____	_____	_____
Shumin Wang (王淑敏)	Zhang Ming (张 明)	Yuchun Wang (王雨春)

杨 逊		

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023 年 2 月 22 日




第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

_____ Shumin Wang (王淑敏)	_____ Chris Chang Yu (俞 昌)	_____ 朱沛文
_____ 杨 磊	_____  郝一阳	_____ 张天西
_____ 李 华	_____ 任亦樵	

全体监事签名：

_____ 高 琦	_____ 陈智斌	_____ 冯 倩
--------------	--------------	--------------

高级管理人员签名：

_____ Shumin Wang (王淑敏)	_____ Zhang Ming (张 明)	_____ Yuchun Wang (王雨春)
_____ 杨 逊		

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023 年 2 月 22 日

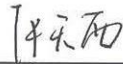


第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

Shumin Wang (王淑敏)	Chris Chang Yu (俞 昌)	朱沛文
杨 磊	郝一阳	 张天西
李 华	任亦樵	

全体监事签名：

高 琦	陈智斌	冯 倩
-----	-----	-----

高级管理人员签名：

Shumin Wang (王淑敏)	Zhang Ming (张 明)	Yuchun Wang (王雨春)
杨 逊		

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2023年2月22日




第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

_____ Shumin Wang (王淑敏)	_____ Chris Chang Yu (俞 昌)	_____ 朱沛文
_____ 杨 磊	_____ 郝一阳	_____ 张天西
_____  李 华	_____ 任亦樵	

全体监事签名：

_____ 高 琦	_____ 陈智斌	_____ 冯 倩
--------------	--------------	--------------

高级管理人员签名：

_____ Shumin Wang (王淑敏)	_____ Zhang Ming (张 明)	_____ Yuchun Wang (王雨春)
_____ 杨 逊		

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023 年 2 月 22 日



第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

_____	_____	_____
Shumin Wang (王淑敏)	Chris Chang Yu (俞昌)	朱沛文
_____	_____	_____
杨磊	郝一阳	张天西
_____	_____	_____
李华	 任亦樵	_____

全体监事签名：

_____	_____	_____
高琦	陈智斌	冯倩

高级管理人员签名：

_____	_____	_____
Shumin Wang (王淑敏)	Zhang Ming (张明)	Yuchun Wang (王雨春)
_____	_____	_____
杨逊	_____	_____

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023年2月22日



第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

Shumin Wang
(王淑敏)

Chris Chang Yu
(俞昌)

朱沛文

杨磊


郝一阳

张天西

李华

任亦樵

全体监事签名：


高琦

陈智斌

冯倩

高级管理人员签名：

Shumin Wang
(王淑敏)

Zhang Ming
(张明)

Yuchun Wang
(王雨春)

杨逊

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2023年2月22日



第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露条件，符合适用简易程序的要求。

全体董事签名：

_____	_____	_____
Shumin Wang (王淑敏)	Chris Chang Yu (俞 昌)	朱沛文
_____	_____	_____
杨 磊	郝一阳	张天西
_____	_____	
李 华	任亦樵	

全体监事签名：

_____	_____	_____
高 琦	陈智斌	冯 倩

高级管理人员签名：

_____	_____	_____
Shumin Wang (王淑敏)	Zhang Ming (张 明)	Yuchun Wang (王雨春)

杨 逊		

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2023 年 2 月 22 日



二、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。本公司承诺公司本次发行上市，符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的要求。



控股股东: Anji Microelectronics Co., Ltd.

董事签名: 

Shumin Wang

(王淑敏)

2023 年 2 月 22 日

三、保荐机构(主承销商)声明

本公司已对募集说明书进行了核查,确认本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

项目协办人: 徐琰
徐琰

保荐代表人: 康杰
康杰

周毅
周毅

法定代表人: 张剑
张剑

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年2月22日

保荐机构（主承销商）董事长及总经理声明

本人已认真阅读本募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构董事长、总经理：


张 剑

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年2月22日

四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘



经办律师：胡家军

经办律师：严杰






经办律师：高萍

2023年2月22日



五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（“募集说明书”），确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


徐海峰  刘许友（已离职）

杨洁  黄晓冬 

会计师事务所负责人：


邹俊 

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年 2 月 22 日



关于本所签字注册会计师离职的说明

本所出具的安集微电子科技（上海）股份有限公司 2019 年度及 2020 年度财务报表的审计报告（毕马威华振审字第 2001044 号、毕马威华振审字第 2102132 号）的签字注册会计师刘许友，注册会计师证书编号为：110002410014，已于 2022 年 6 月从本所离职，因此其无法在本所为安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书出具的承诺书上签字。

特此说明。

会计师事务所负责人签名：


邹俊



毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



2023 年 2 月 22 日

六、发行人董事会声明

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

1、加大产品研发和市场拓展力度，提升公司市场地位和盈利能力

公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。公司成功打破了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品的垄断，实现了进口替代，使中国在该领域拥有了自主供应能力。同时，公司依靠自主创新，在特定领域实现技术突破，使中国具备了引领特定新技术的能力。

未来公司将加大产品研发和市场拓展力度，不断提升公司的市场地位和盈利能力，一方面公司将围绕自身的核心技术，依托现有技术平台，在抛光液板块，积极加强、全面开展全品类产品线的布局，旨在为客户提供完整的一站式产品和解决方案；在功能性湿电子化学品板块，专注致力于攻克领先技术节点难关并提供相应的解决方案。另一方面，公司将积极进行市场开拓，加强客户拓展，加快产品的测试论证及销售放量。

2、提升公司经营管理水平，完善公司治理结构

公司将改进完善业务流程，提高经营效率，加强对研发、采购、销售等各环节的管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对公司董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保障。

3、加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高募集资金运用效率，争取募投项目早日达成并实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。

4、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定以及公司《募集资金管理使用制度》的要求对募集资金进行专户存储和使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用风险。

5、严格执行分红政策，强化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，增加利润分配决策透明度、更好的回报投资者，维护股东利益，公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求在《公司章程》中制定了利润分配相关条款，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等。同时，公司已制定《安集微电子科技（上海）股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行股东回报政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，努力提升股东回报水平。

公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司控股股东出具的承诺

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，为确保公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出承诺如下：

“1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、本公司承诺出具日后至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且

上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的法律责任。”

2、公司董事、高级管理人员出具的承诺

根据相关法律、法规和规范性文件的要求，为确保公司本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出承诺如下：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日后至本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日

